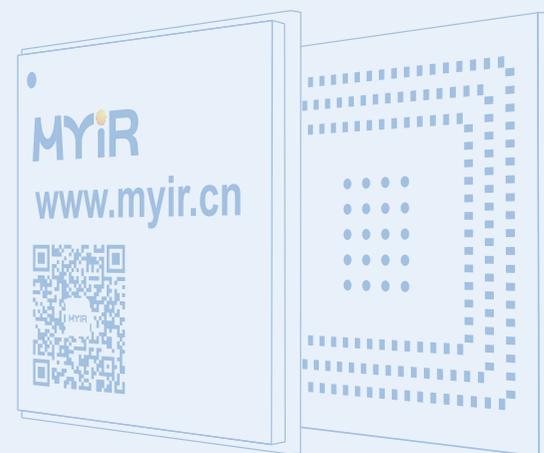


产品手册



领先的嵌入式处理器模组厂商

目录

01 米尔介绍

| | |
|--------|---------|
| 米尔介绍 | 02 ~ 14 |
| 选型表 | 15 ~ 16 |
| 命名规则 | 17 |
| 产品选型工具 | 18 |

02 SOM核心板

| | |
|--------|---------|
| ST系列 | 20 ~ 23 |
| NXP系列 | 24 ~ 30 |
| AMD系列 | 31 ~ 36 |
| 瑞萨系列 | 37 ~ 39 |
| TI 系列 | 40 ~ 43 |
| 全志系列 | 44 ~ 48 |
| 芯驰系列 | 49 ~ 52 |
| 瑞芯微系列 | 53 ~ 56 |
| 新唐系列 | 57 |
| 海思系列 | 58 |
| 紫光同创系列 | 59 |
| 安路系列 | 60 |

03 方案与应用

| | |
|-------|---------|
| 工业单板机 | 61 ~ 71 |
| 工控一体机 | 72 ~ 76 |

04 定制服务

| | |
|-------|----|
| ODM服务 | 77 |
| OEM服务 | 78 |

关于米尔

深圳市米尔电子有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组设计、研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业和专精特新企业。

米尔电子深耕嵌入式领域10多年，致力于为企业级客户提供基于ARM、FPGA、RISC-V和AI等各种架构，稳定可靠的处理器模组，满足客户大批量产品应用部署的需求，同时为客户提供产品定制设计、行业应用解决方案和OEM的一站式服务。

米尔英文简称“MYiR”，是“Make Your Idea Real”第一个大写字母的缩写。我们的理念是“专业服务助力客户成功”，目前米尔已通过专业高效的服务，帮助全球数万家企业的产品成功上市。



15⁺年
行业经验

45⁺%
研发人员占比

7000⁺M²
研发生产基地

60⁺国
产品销往全球

150⁺项
专利及荣誉

30000⁺
企业客户

发展历程

2011-2012

- 成立深圳总部
- 成立北京分公司
- 成立上海分公司
- 成为ARM官方合作伙伴
- 成为Xilinx官方合作伙伴

2013-2017

- 成为TI官方合作伙伴
- 成为NXP官方合作伙伴
- 成为AVNET官方合作伙伴
- 成立米尔武汉分公司及研发中心
- 总部乔迁至深圳坂田云里智能园

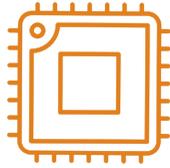
2018-2021

- 深圳观澜SMT智慧工厂落成投产
- 成为ST官方合作伙伴
- 成为芯驰官方合作伙伴
- 成为Mouser官方合作伙伴
- 成为DigiKey官方合作伙伴
- 获评国家级高新技术企业
- 获得ISO9001质量管理体系认证
- 获得ISO14001环境管理体系认证

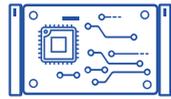
2022-2025

- 成为瑞萨IDH生态合作伙伴
- 成为全志官方合作伙伴
- 成为瑞芯微官方合作伙伴
- 成为新唐官方合作伙伴
- 获得南瑞认证优质供应商
- 获得许继认证优质供应商
- 获得ST授予合作伙伴大奖
- 获评深圳市专精特新企业

主营业务



SOM核心板



SBC工控板



Solution解决方案



ODM定制服务



OEM代工服务

覆盖领域



充电桩



储能



电力



PLC



工业自动化



工业网关



商业显示



医疗器械



工程机械



轨道交通



工业HMI



AI边缘计算

企业文化

企业使命

构建数字化、智能化、网络化嵌入式产品基石，
为智能制造和智慧生活赋能

企业愿景

成为全球行业客户最信赖的嵌入式处理器
模组供应商

企业价值观

共创、共赢、共享，为客户创造最大价值

信息化管理平台

米尔建立了一系列专业成熟的企业级的信息化管理平台，从物料供应链、产品研发、客户管理、项目管理、员工管理、生产管理等各维度实现全面数字化管理，让业务数据化，让管理可视化，让生产智能化。

企业管理 EPR系统

客户管理 CRM管理系统

供应商管理 SRM管理系统

产品管理 PLM、DFX系统

生产管理 MES、WMS仓储管理 WMS智能仓储系统

经营理念

领先技术

不断进行技术创新，为客户提供行业领先的技术和产品。

专业服务

系统化构建客户服务体系，提供售前、售中、售一体化技术支持。

交付承诺

提供不低于10年的产品生命周期保障。

品质保障

ISO管理体系，贯穿物料选型、研发设计、产品测试、生产加工和出货等环节。

企业资质和荣誉



国家高新技术企业



深圳市专精特新中小企业



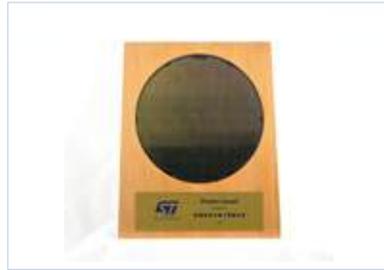
ISO9001



ISO14001



瑞萨IDH生态合作伙伴



ST授予合作伙伴大奖



省试点应用突出贡献奖



深圳市人工智能产业协会



83项

CE、ROHS认证



46项

软件著作权



25项

实用新型专利



18项

发明专利



16项

电路设计



29项

行业媒体奖项

战略合作伙伴



部分企业客户



研发能力

米尔在深圳和武汉都设立了研发中心，拥有资深的技术研发团队，其中研发人员占比45%左右，100%以上拥有本科以上学历，研发团队核心骨干和主要成员均长期深耕嵌入式行业，具备10多年嵌入式行业工作经验，有先进的设计理念和针对大批量产品应用的设计实践。产品具备行业领先的创新性、可靠性和稳定性，累计申请专利、著作权及各种认证100多项。



完善、科学、系统的研发管理体系

研发管理齐备
采用IPD流程管理理念，结合现代化的信息系统管理工具

项目管理

任务管理

缺陷管理

评审管理

设计文件

代码管理

知识经验管理

设计能力优化
建立完善且统一的关键设计节点管控

测试用例

原理图/PCB CheckList

标准电路库

DFX管理

高速信号设计与仿真

物料AVL优选库

技术与技能

硬件开发

- 标准的器件库
- 标准的电路图
- 完整的原理图
(PCB Checklist)
- FMEA分析
- SI仿真设计

软件开发

- 多种操作系统开发能力
Linux | android | RTOS | OpenHarmony | OpenEuler
- 内核移植及驱动开发能力
- 系统优化能力
开机时间、实时性、多系统备份、OTA、安全性等优化
- 符合工业及电力场景系统定制能力
- 协议开发和应用开发能力

测试能力

米尔研发测试团队秉承科学严谨、客观公正的态度，依托完善的测试体系和专业丰富的测试经验，对所有产品均依据相关国标、行业标准、公司标准，严格实施全方位测试，确保所有产品具备长期稳定性、可靠性、可批量生产性和数据可溯性。

● 涉及标准范围

- I2C-bus specification and user manual V.6.pdf
- I2S specification Revision June 5 1996.pdf
- Part E1 SDIO Simplified Specification Version 2.00
- 对应芯片数据手册

● 主要评测项目

电源测试

- ✓ 对地阻抗测试
- ✓ 纹波测试
- ✓ 上下电波形测试
- ✓ 上下电时序测试
- ✓ 功耗测试
- ✓ Power Noise测试

信号测试

- ✓ I2C/I2S测试
- ✓ SDIO测试
- ✓ 时钟测试
- ✓ 网口信号测试
- ✓ UART测试
- ✓ CAN测试
- ✓ RS232/RS485

信号测试

● 涉及标准范围

- EN55032
- NB/T33008.1
- IEC61000-4
- GB/T 17626

● 主要评测项目

EMI:电磁干扰

- ✓ RE:辐射发射
- ✓ Harmonics:谐波电流
- ✓ CE:传导发射
- ✓ Flicker:闪烁

EMS:电磁敏感

- ✓ RS:辐射抗扰度
- ✓ CS:传导抗扰度
- ✓ ESD:静电抗扰度
- ✓ Surge:浪涌抗扰度
- ✓ EFT/B:电快速瞬变脉冲群
- ✓ PMS:工频磁场抗扰度
- ✓ Dips:电压跌落/短时中断

EMC测试

● 涉及标准范围

- EN 55032:2015
- EN 61000-3-3:2013
- IEC62321
- EN 55035:2017
- EN IEC 61000-3-2:2019

● 主要评测项目

- ✓ CE认证
- ✓ ROHS认证
- ✓ 国产化认证

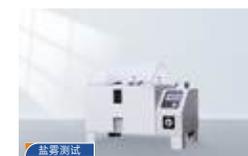
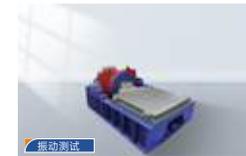


认证测试

● 涉及标准范围

- GB/T 2423.1-2008
- GB/T 2423.2-2008
- GB/T 2423.22-2012
- GB/T 2423.8-1995
- GB/T 2423.10-2019
- GB/T 2423.5-2019
- GB/T 2423.17-2008
- GB/T 19056-2012

● 主要评测项目



可靠性测试

技术服务

米尔以客户需求为导向，客户在项目选型、项目立项、项目开发、产品测试、小批量试产、大批量生产等过程中遇到的各种问题，米尔都提供全方位的技术支持和服务。公司一线工程师团队通过在线、电话、邮箱、远程视频会议、现场服务等多种方式协助客户解决技术问题，并提供丰富的学习资料，致力于加速客户开发进程，降低客户开发成本，确保客户产品质量，提升客户产品市场竞争力。

售前服务

沟通与需求分析

技术服务团队全方位参与分析了解客户需求

产品选型工具

提供在线系统，快速便捷精准的产品选型

顾问式的选型指导

专业团队推荐性能、功能及成本最佳核心板

软硬件框架搭建

确保整体软硬件系统设计符合客户的需求

原型验证

确保选定平台的系统设计的可行性和稳定性

项目技术风险评估

识别潜在风险并提出解决方案和应对措施

售中服务

开发者中心系统

快捷下载产品资料和技术文档，售后可可视化服务等

原理图及PCB设计指导与评审

确保电路设计布局满足系统性能和稳定性要求

协助样机底层驱动调试

确保硬、软件的兼容性，验证驱动的功能和性能

协助中间件移植

确保系统的正常运行和功能完整性

协助系统优化裁剪

提高系统性能和稳定性，同时减少资源占用

物料选型指导

从质量、性能和价格等提供建议，提高产品竞争力

测试方案指导

确保项目在上线前达到质量标准，保障产品稳定性

生产工艺指导

提供生产工艺指导文件，确保产品效率和品质

研发打样服务

提供一站式打样服务，分析存在问题和提出建议

● 售后服务

☰ 远程或现场服务

提供保姆式服务，及时响应客户需求，包括抵达客户现场解决问题

☑ 问题记录与整理

每个客户问题单独备案，以便跟踪问题的根本原因和持续改进措施

📖 培训与知识分享

帮助客户更好地理解产品使用和维护，提高其技术和产品应用水平

👥 输出8D报告

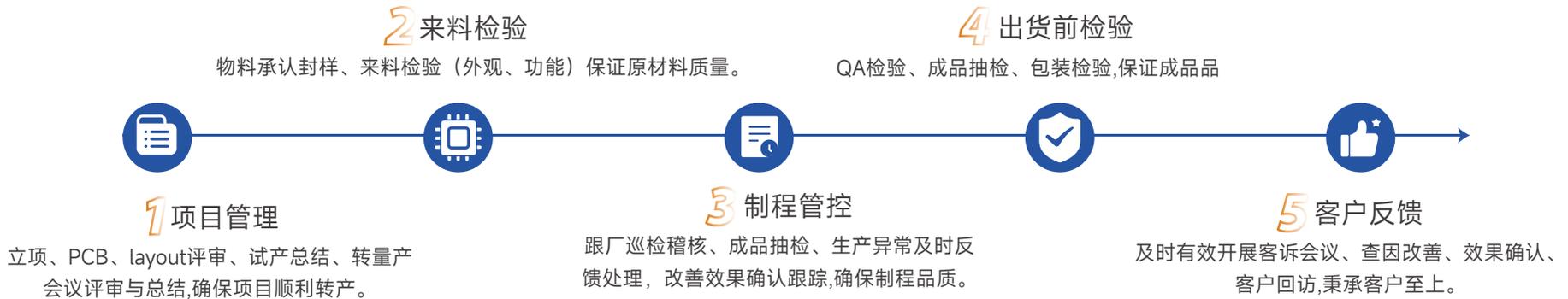
内容包含问题描述、根本原因分析、纠正措施、预防措施、改进建议等

🛡️ 返修换货服务

提供产品快速返修和换货服务，米尔的生产体系可以实现产品级和物料级的批次追溯，方便定位问题，分析问题，解决问题，并提供分析报告和使用建议

🔧 质量保障

米尔从物料来料检验、上线前烘烤、锡膏印刷检测、在线AOI、首件检测、X-RAY抽检、IPQC巡检、QA出货全检层层检验关卡，全方位防静电实时监测，坚持运行ISO9001质量管理体系，保证产品出厂合格率。



● **系统化的仓储管理**

仓库采用X-ray自动点料机和AI智能感应料架，对元器件仓库采用恒温恒湿、防静电、先进先出的管控机制，支持多工单发料，能够实时盘点，物料防丢防错，对接MES和ERP系统，使用及管理全过程可追溯。



WMS智能仓储系统

智能货架搭配智能仓储系统，实现物料零出错



恒温、恒湿、安全

集成电路和电子元器件采用恒温恒湿仓库及存储柜，确保物料的有效及可靠性。



● **完整的供应链体系**

拥有10年以上行业经验的资深供应链管理团队，提供全BOM物料供应、器件选型和替代料推荐，配备专业的BOM工程师和严格、规范的IQC来料检验标准，以及源自原厂和一级代理商的原装正品保证，确保为客户提供交期短、品质好、价格低的元器件保障。



1000+原厂及代理商合作（部分合作供应商）



生产能力

米尔拥有5000平米的SMT智慧工厂，打造10万级洁净无尘车间，配备多条SMT生产线，以先进的生产设备和管理系统、严格的品质管控流程、完善的供应链体系、强力的工程支撑等优势，从来料到制程再到出货，层层把关，确保产品质量。工厂贴片能力达到日产能500余万点。所有生产流程符合RoHS和REACH标准。

完善的自动化生产设备

配备松下进口高速双轨贴片线，拥有全自动锡膏印刷机、氮气回流炉、波峰焊、AOI、SPI、X-RAY、智能首件检测仪、智能锡膏管理柜、全自动分板机、三防漆自动涂覆、镭雕机、BGA返修台等设备，并配套MES智能管理系统、智能仓储系统、ERP系统和静电管理系统。



全自动锡膏印刷机



全自动锡膏检测仪（3D SPI）



NPM-D3A贴片机



NPM-TT2贴片机



在线AOI



三防漆自动涂覆线

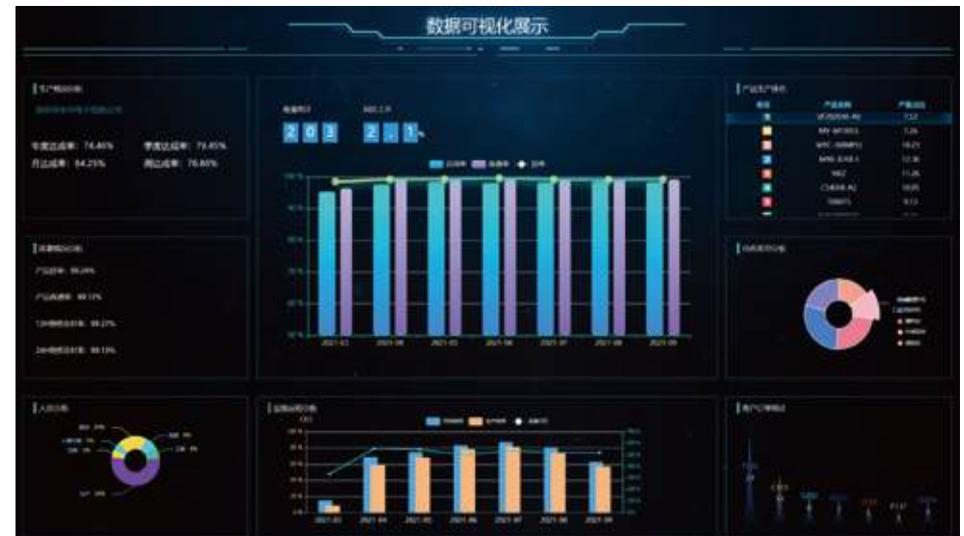
● 优异的生产环境条件

生产车间设备及流水线工位均安装有LoRa静电监测结点，静电超标可声光报警，并通过网关采集实时传送到数据后台，车间整体静电数据可在大屏上多维度动态展示。



● 一体化制造信息化管理系统

业界领先的一体化制造信息化管理系统(MES)，实现与ERP、WMS、SRM等系统对接，提高了工厂管理的实时性和透明度，以及产品的全过程追溯和防错管控水平。



| 处理器品牌 | 进口处理器 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 产品性能 |  |  |  |  |  |
| 入门级 A7/A8/A9/ A55/FPGA 1-2核 | MYC-YF13X P20 ST STM32MP135 A7@1.0GHz 2×千兆以太网、8×UART、Parallel CSI 2×CAN FD、Parallel LCD | MYC-Y6ULX-V2 P24 NXP i.MX6UL/i.MX6ULL A7@528MHz 2×百兆以太网、2×CAN、8×UART Parallel LCD、Parallel CSI | MYC-J7A100T P31 AMD Atrix 7A100T FPGA: 101K 2×千兆以太网、HDMI、UART Camera、2×SFP、PCIe2.0 | MYC-YG2UL P37 Renesas RZ/G2UL A55@1.0GHz+M33@200MHz 2×千兆以太网、2×USB2.0、1×MIPI CSI 7×UART、2×CAN FD、3×SPI、1×RGB | MYC-C335X-V4 P40 TI AM335X A8@1.0GHz 2×千兆以太网、2×CAN、6×UART 3D GPU、PRU、Parallel LCD |
| | MYC-YA15XC-T P21 ST STM32MP151 A7@650MHz+M4@209MHz 1×千兆以太网、8×UART Parallel LCD、Parallel CSI | MYC-LMX91 P25 NXP i.MX91 A55@1.4GHz 2×RGMII、2×USB2.0、8×UART、 8×I2C、2×I3C、2×CAN FD、8×SPI | MYC-C/Y7Z010/20-V2 P32 AMD XC7Z010/20 ARM: 2×A9@766MHz, FPGA: 85K 千兆以太网、LCD、USB2.0、CAN UART | | MYC-C335X-GW P41 TI AM335X A8@1.0GHz 2×千兆以太网、2×CAN、6×UART 3D GPU、PRU、Parallel LCD |
| | MYC-YA157C-V3 P22 ST STM32MP157 2×A7@650MHz+M4@209MHz 1×千兆以太网、8×UART、MIPI DSI 2×CAN FD、3D GPU | | MYC-C7Z015 P34 AMD XC7Z015 ARM: 2×A9@766MHz FPGA: 74K 千兆以太网、LCD、USB2.0、CAN UART、PCIe2.0、SFP | | MYC-C437X-V2 P42 TI AM437X A8@1.0GHz 2×千兆以太网、2×CAN、6×UART 3D GPU、PRU、Parallel LCD |
| 中端性能 A35/A53/A55 2-4核 | MYC-LD25X P23 ST STM32MP257 2×A35@1.5GHz+M33@400MHz 3×RGMII、4×USART、MIPI DSI、 5×UART、3×CAN FD、Parallel RGB | MYC-LMX9X P26 NXP i.MX93 2×A55@1.7GHz+M33@250MHz 2×千兆以太网、2×CAN FD、8×UART LVDS、MIPI DSI、MIPI-CSI | MYC-CZU1EG/3EG-V3 P35 AMD XCZU1EG/3EG ARM: 4×A53@1333MHz+2×R5@533MHz FPGA: 81K(1EG)/154K(3EG) 千兆以太网、CAN、LCD、USB3.0 FMC、DP、SATA3.0、UART、PCIe2.0 | MYC-YG2LX P38 Renesas RZ/G2L 2×A55@1.2GHz+M33@200MHz 2×千兆以太网、2×USB2.0、7×UART、 2×CAN FD、3D GPU、VPU、MIPI DSI | MYC-YM62X P43 TI AM62X 1/2/4×A53@1.4GHz+M4F@400MHz 2×千兆以太网、3×CAN FD、9×UART 3D GPU、PRU、GPMC、LVDS |
| | | MYC-C8MMX-V2 P27 NXP i.MX 8M Mini 4×A53@1.8GHz+M4@400MHz 1×千兆以太网、4×UART、1×PCIe2.0 MIPI DSI、MIPI-CSI、3D GPU、VPU | | | |
| 高端性能 A53/A55/A72 2-8核 | | MYC-JX8MPQ P28 NXP i.MX 8M Plus 4×A53@1.6GHz+M7@800MHz 2×千兆以太网、2×CAN FD、PCIe2.0、 2×USB3.0、NPU、MIPI DSI、HDMI | MYC-CZU4EV/5EV-V2 P36 AMD XCZU4EV/5EV ARM: 4×A53@1333MHz+2×R5@533MHz FPGA: 192K(4EV)/256K(5EV) 千兆以太网、CAN、LCD、USB3.0 FMC、DP、SATA3.0、UART、PCIe2.0 | MYC-YT2HX P39 Renesas RZ/T2H 4×A55@1.2GHz+2×R52@1.0GHz RGMII、3×RMII、30×DSMIF、ENCIF 4×SPI、PCIe3.0、External bus、XSPI | |
| | | MYC-J1028X P29 NXP LS1028A 2×A72@1.5GHz 4×TSN Switch、2×GbE、DP1.3/eDP1.4 2×USB3.0、2×PCIe3.0、SATA 3.0 | | | |
| | | MYC-JX8MMA7 P30 NXP i.MX 8M Mini+ AMD Atrix 7 ARM: 4×A53@1.8GHz+M4@400MHz FPGA: 23K 千兆以太网、2×USB2.0、4×UART、3×SPI、MIPI-DSI、MIPI CSI | | | |

| 处理器品牌 | 国产处理器 | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|
| 产品性能 |  |  |  |   |   |
| 入门级 A7/A8/A9/ A55/FPGA 1-2核 | MYC-YT113i P44 Allwinner T113-i 2×A7@1.2GHz 1×千兆以太网、6×UART、Parallel CSI MIPI DSI、RGB、2×LVDS、2×CAN | | MYC-YR3506 P53 Rockchip RK3506B/J 3×A7@1.5GHz+M0@200MHz 2×RMII、Flexbus、3×SPI、2×USB2.0 6×UART、2×CAN、3×I2C、12×PWM | | MYC-J2L100H P59 PANGO Logos2 2L100H 2×千兆以太网、HDMI、UART Camera、2×SFP、PCIe2.0 |
| | MYC-YT113X P45 Allwinner T113-S3 2×A7@1.2GHz 1×千兆以太网、6×UART、Parallel CSI MIPI DSI、RGB、2×LVDS、2×CAN | | | | |
| 中端性能 A35/A53/A55 2-4核 | MYC-YT507H P46 Allwinner T507H 4×A53@1.5GHz 千兆以太网、百兆以太网、6×UART 4×USB2.0、2×LVDS、RGB、3D GPU | MYC-JD9340 P49 SemiDrive D9340 4×A55@1.6GHz+2×R5@800MHz 2×千兆以太网、2×USB3.0、2×PCIe3.0 4×CAN FD、8×SPI、12×I2C、8×PWM | MYC-YR3562 P54 Rockchip RK3562(J) 4×A53@2.0GHz+M0@200MHz 千兆以太网、百兆以太网、10×UART 16×PWM、USB2.0、2×CAN、SDIO | MYC-LMA35 P57 Nuvoton MA35D1 2×A35@800MHz+M4@180MHz 2×千兆以太网、4×CAN FD、17×UART 16bit EBI、24bit RGB、2×USB2.0 | MYC-YM90X P60 安路科技 SALDRAGON ARM: 2×A35@1.0GHz FPGA:95K 2×千兆以太网、2×CAN-FD、2×USB2.0 2×UART、2×SD/SDIO、2×SPI、2×I2C |
| | MYC-LT536 P47 Allwinner T536 4×A55@1.6GHz+RISCV@600MHz 2×千兆以太网、17×UART、4×I2S 2×USB2.0、Localbus、4×CAN FD | | MYC-LR3568 P55 Rockchip RK3568(J) 4×A55@1.8GHz 2×千兆以太网、2×HDMI、2×MIPI CSI eDP1.3、4×USB、2×PCIe3.0、SATA3.0 | MYC-LHI3093 P58 HISILICON Hi3093 4×A55@1.0GHz+2×M3@200MHz 2×GE、2×FE、3×USB、2×PCIe、VGA 2×CAN、8×UART、16×I2C、12×PWM | |
| 高端性能 A53/A55/A72 2-8核 | MYC-LT527 P48 Allwinner T527 8×A55@1.8GHz+RISC-V@200MHz 2×千兆以太网、HDMI、MIPI-DSI/CSI 3×USB、2×CAN、10×UART、4×SPI | MYC-JD9350 P50 SemiDrive D9350 5×A55@1.6GHz+3×R5@800MHz 2×千兆以太网、2×USB3.0、2×PCIe3.0 4×CAN FD、8×SPI、12×I2C、8×PWM | MYC-LR3576 P56 Rockchip RK3576(J) 4×A72@2.2GHz+4×A53@1.8GHz 2×千兆以太网、PCIe、USB3、SATA3、 DSMC/FlexBus、2×CANFD、12×UART | | |
| | | MYC-JD9360 P51 SemiDrive D9360 6×A55@1.6GHz+R5@800MHz 2×千兆以太网、2×USB3.0、2×PCIe3.0 4×CAN FD、8×SPI、12×I2C、8×PWM | | | |
| | | MYC-YD9360 P52 SemiDrive D9360 6×A55@1.6GHz+R5@800MHz 2×千兆以太网、2×USB3.0、2×PCIe3.0 4×CAN FD、8×SPI、12×I2C、8×PWM | | | |

米尔产品命名规则



米尔电子官网产品选型工具

让产品选型更简单、更高效、更精准!

登录入口: www.myir.cn/lists



扫码即可体验

筛选产品分类,
快速定位类别产品



勾选4款处理器模组,
即可对比具体参数

米尔核心板优势



● 创新性设计

- ▶ LCC/LGA封装设计：更稳定可靠的信号连接，更好的抗震动，便于量产批量贴片
- ▶ 屏蔽罩设计：抗信号干扰和防灰尘，同时支持定制化LOGO，提升客户品牌价值
- ▶ 小巧紧凑设计：体积小，设计灵活，适合各种尺寸产品（特别是结构受限产品）

● 卓越的品质

- ▶ 严苛的测试：核心板通过信号、高低温、老化测、静电等6项测试，确保产品稳定性
- ▶ 符合国际认证标准：采用国际SGS作为认证测试伙伴，提供CE和ROHS认证报告
- ▶ 自建智慧工厂：配备一流生产设备，采用MES系统等，保障产品高质量及可追溯性

● 领先的成本

- ▶ 规模效应：核心板每年出货100万片以上，通过规模化生产获得优良的批量物料成本
- ▶ 封装优势：核心板采用LCC/LGA封装设计，可以节省板对板连接器的成本
- ▶ 供应链管理：与各原厂建立深度紧密的合作关系，获得更具竞争力的芯片价格支持

● 快速交付及长生命周期

- ▶ 交期短：完善的标准品库存管理机制，样品订单现货交付，批量订单2~4周交付
- ▶ 生命周期长：10年以上的供货保障，物料停产替代有完善的产品变更流程和通知政策
- ▶ 长期维护：软件长期维护并定期更新BSP包

● 保姆式的技术服务

- ▶ 售前服务：选型阶段最优平台推荐、可行性评估、软硬件框架搭建以及原型功能验证
- ▶ 售中服务：设计阶段原理图、PCB指导与评审，驱动调试、中间件移植和系统优化
- ▶ 售后服务：FAE沟通及时，远程或现场协助解决问题，并记录过程，输出8D报告

● 丰富的开发资源

- ▶ 硬件文档：产品手册、硬件设计指南、硬件用户手册以及核心板引脚使用表
- ▶ 软件文档：快速使用指南、软件开发指南、软件评估指南以及应用笔记
- ▶ 设计资料：底板原理图及PCB源文件，BSP软件源代码以及行业应用DEMO



MYC-YF13X核心板

- 基于STM32MP135新一代通用工业级MPU，具有极高的性价比，内核Cortex-A7@1GHz
- 标准配置支持256M Nand Flash/256M DDR和4GB eMMC/512M DDR两种
- 接口丰富：2路千兆网口、LCD-TFT并行显示接口、Parallel CSI、2个CAN、2个USB、8个UART功能接口
- LCC封装，148PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------|-------|--------------------------|
| MYC-YF135-256N256D-100-I | STM32MP135DAF7 | Cortex-A7@1.0GHz | 256MB DDR3 | 256MB Nand Flash | 32Kbit EEPROM | LCC 148PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux | MYD-YF135-256N256D-100-I |
| MYC-YF135-4E512D-100-I | | | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | | | | | | MYD-YF135-4E512D-100-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×CAN FD、2×USB2.0、8×UART、5×SPI、5×I2C |
| 多媒体接口 | RGB、DCMI、2×SAI、3×I2S |
| 其他接口 | 12bit 19ch ADC、12bit 18ch ADC、SWD |

● 应用场景



工业HMI



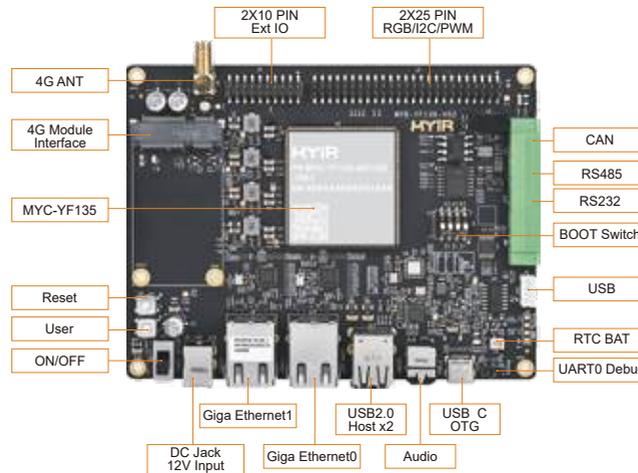
工业网关



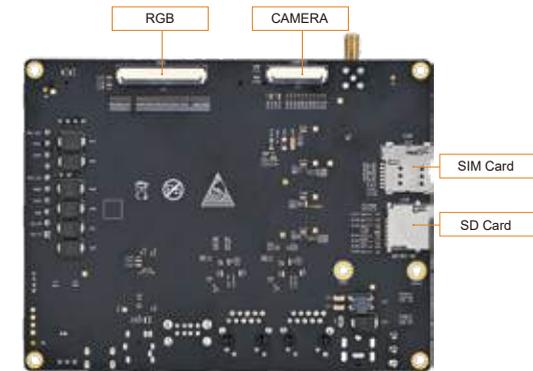
工业控制



能源管理



开发板正面标注图



开发板背面标注图



MYC-YA15XC-T核心板

- 基于新一代STM32MP151处理器，高速计算机处理能力，内核Cortex-A7@650MHz+Cortex-M4@209MHz
- 可用STM32MCU生态系统
- 接口丰富：千兆以太网接口、2个USB2.0接口、8路UART、6路SPI、6路I2C
- LCC封装，148PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



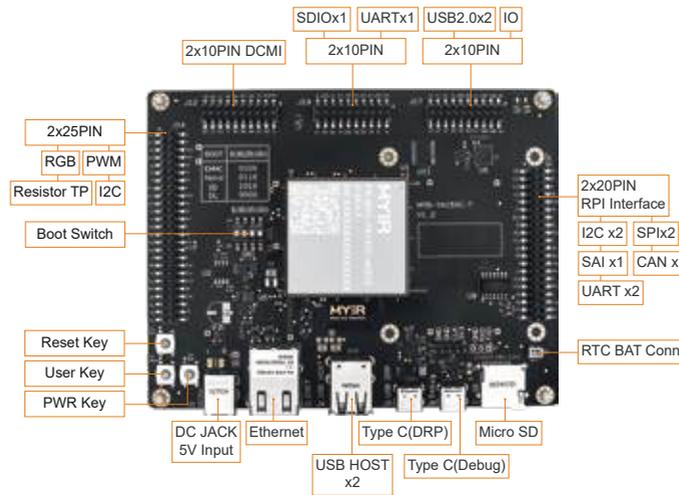
扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| MYC-YA151C-256N256D-65-C-T | STM32MP151AAC3 | Cortex-A7@650MHz +Cortex-M4@209MHz | 256MB DDR3 | 256MB Nand Flash | 32kbit EEPROM | LCC 148PIN | 0°C~+70°C | 37×39mm | Linux | MYD-YA151C-V2-256N256D-65-C-T |
| -40°C~+85°C | | | | | | | MYD-YA151C-V2-256N256D-65-I-T | | | |
| 0°C~+70°C | | | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | | | MYD-YA151C-V2-4E512D-65-C-T | | | |
| -40°C~+85°C | | | | | | | MYD-YA151C-V2-4E512D-65-I-T | | | |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 通信接口 | RGMI2, 2×USB2.0, 8×UART, 6×SPI, 6×I2C |
| 多媒体接口 | RGB, DCMI, 4×SAI, 3×I2S |
| 其他接口 | 2×16bit 20ch ADC, SWD |



开发板正面标注图



开发板背面标注图

● 应用场景



商业HMI



医疗器械



工业制造



石化



MYC-YA157C-V3核心板

- 基于STM32MP157处理器，支持多种应用场景的HMI2.0应用，内核2×Cortex-A7@650MHz+Cortex-M4@209MHz
- 满足各类场景的资源要求，智能家居，卫生医疗，公共服务等系统场景，支持STM32MCU生态系统
- 接口丰富：千兆以太网接口、2个CAN接口、2个USB2.0接口、8路UART、6路SPI、6路I2C
- LCC封装，164PIN；商业级：0°C~+70°C；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、Ubuntu



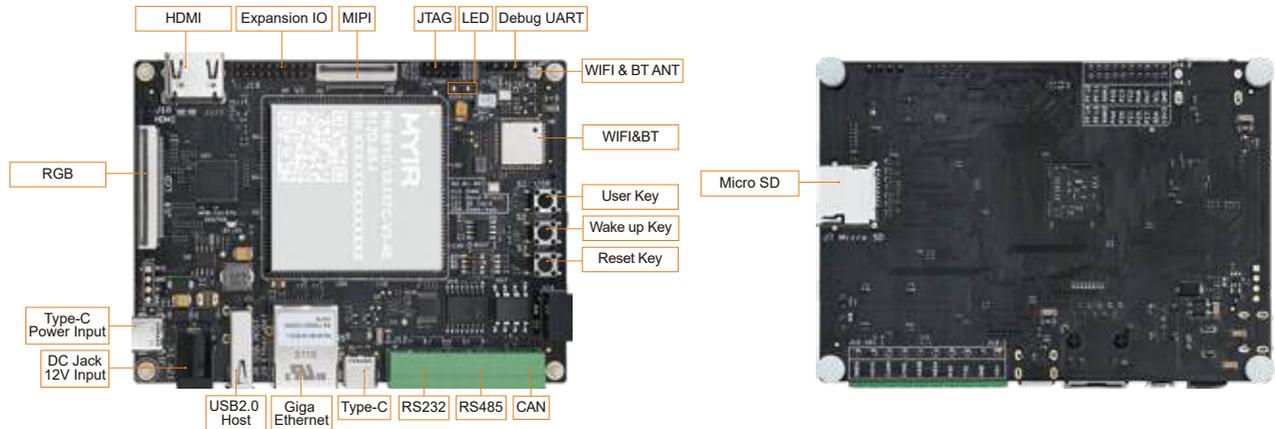
扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|---------------------------|----------------|---|-------------|----------|--------------|------------|-------------|---------|-----------------|---------------------------|
| MYC-YA157C-V3-4E512D-65-C | STM32MP157AAC3 | 2×Cortex-A7@650MHz +Cortex-M4@209MHz | 512MB DDR3L | 4GB eMMC | Ethernet PHY | LCC 164PIN | 0°C~+70°C | 43×45mm | Linux Ubuntu | MYD-YA157C-V3-4E512D-65-C |
| MYC-YA157C-V3-4E512D-65-I | | | | | | | -40°C~+85°C | | | MYD-YA157C-V3-4E512D-65-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | RGMI, 2×CAN FD, 2×USB2.0, 8×UART, 6×SPI, 6×I2C |
| 多媒体接口 | RGB, MIPI DSI, 4×SAI, 3×I2S |
| 其他接口 | 2×16bit 20ch ADC, SWD |



开发板正面标注图

开发板背面标注图

● 应用场景



商业HMI



医疗器械



工业制造

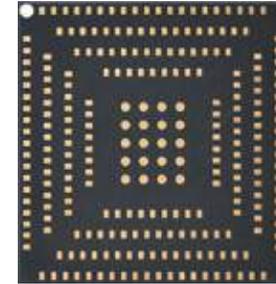


石化



MYC-LD25X核心板

- 基于STM32MP257处理器，2×Cortex-A35@1.5GHz+Cortex-M33@400MHz
- 集成1.35 TOPS的NPU加速器和3D GPU，赋能低成本轻量级AI应用
- 接口丰富：3路千兆以太网接口、3路CAN FD、9路UART、8路SPI、7路I2C
- LGA封装，252PIN；工业级：-40°C~+85°C，尺寸37×39mm；系统Linux、Debian



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------|----------------|---|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| MYC-LD257-8E1D-150-I | STM32MP257DAK3 | 2×Cortex-A35@1.5 GHz +Cortex-M33@400 MHz | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 256Kbit EEPROM | LGA 252PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux Debian | MYD-LD257-8E1D-150-I |
| MYC-LD257-8E2D-150-I | | | 2GB LPDDR4 | | | | | | | MYD-LD257-8E2D-150-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 3×RGMII、USB2.0 HOST、USB3.0 OTG/PCIE2.0、4×USART、5×UART、8×SPI、7×I2C、4×I3C、3×CAN FD、2×SD/MCC |
| 多媒体接口 | Parallel RGB、MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、DCMI、4×SAI |
| 其他接口 | JTAG、SWD |

● 应用场景



高端工业HMI



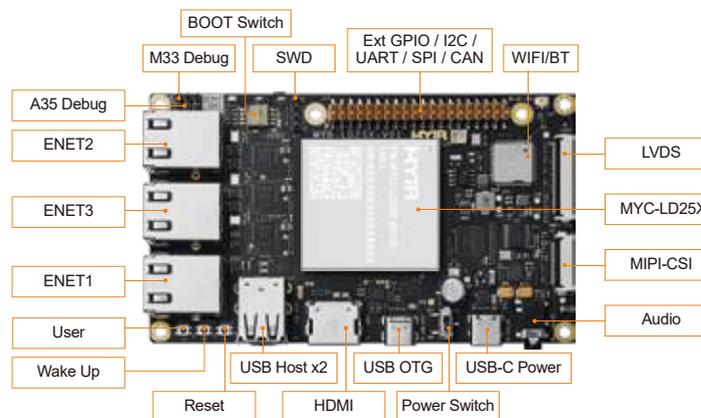
边缘计算网关



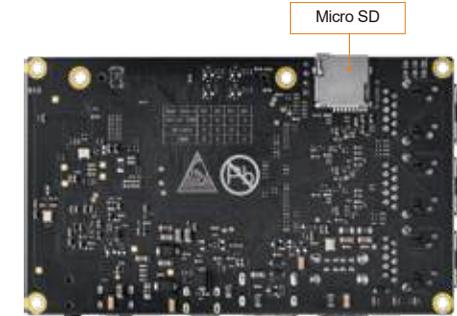
新能源充电桩



储能EMS系统



开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-Y6ULX-V2核心板

- 基于NXP i.MX6UL/i.MX6ULL系列处理器，内核Cortex-A7@528MHz
- 入门级嵌入式系统高质量和高性价比核心平台，适合HMI、物联网网关等领域
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路USB2.0接口、2路CAN、8路UART、4路SPI、4路I2C
- LCC封装，140PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C，尺寸37×39mm，系统Linux



产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|---------|-------|-----------------------------|
| MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C | MCIMX6Y2CVM05AB | Cortex-A7@528MHz | 256MB DDR3 | 256MB Nand FLASH | Ethernet PHY | LCC 140PIN | 0°C~+70°C | 37×39mm | Linux | MYD-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C |
| MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-I | | | | | | | -40°C~+85°C | | | MYD-Y6ULY2-V2-256N256D-50-I |
| MYC-Y6ULY2-V2-4E512D-50-C | | | 0°C~+70°C | MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-C | | | | | | |
| MYC-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I | | | -40°C~+85°C | MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I | | | | | | |
| MYC-Y6ULG2-V2-256N256D-50-I | MCIMX6G2CVM05AB | | 256MB DDR3 | 256MB Nand FLASH | | | | | | MYD-Y6ULG2-V2-256N256D-50-I |

核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RMII、2×CAN、2×USB2.0、8×UART、4×SPI、4×I2C |
| 多媒体接口 | RGB、Parallel CSI、3×I2S |
| 其他接口 | 2×12bit 10ch ADC、JTAG |

应用场景



充电桩



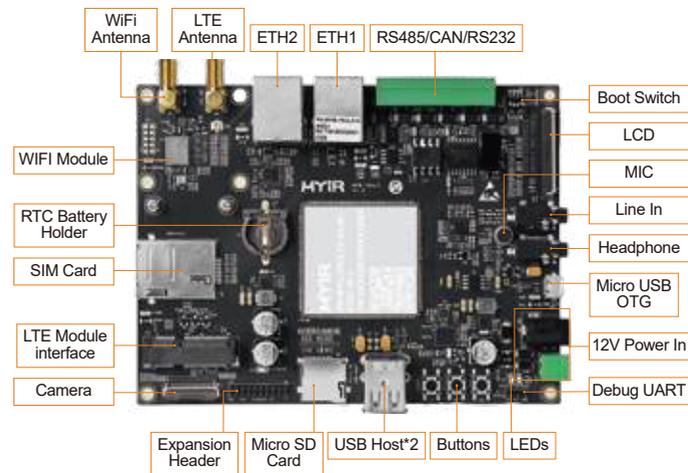
HMI



工业控制



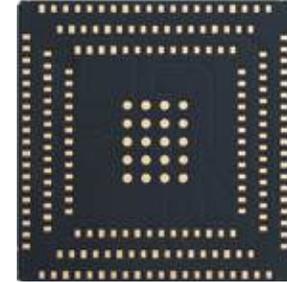
医疗器械



开发板正面标注图

NXP | MYC-LMX91核心板

- 基于NXP i.MX91处理器，内核Cortex-A55@1.4GHz
- 低成本低功耗处理器，助力基础工业及智能家居设备成本优化
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路 CAN FD、8路UART、8路SPI
- LGA 218PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37x39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------|---------|-------|------------------------|
| MYC-LMX9131-8E1D-140-I | MIMX9131CVVXJAA | Cortex-A55@1.4GHz | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 32K Bytes EEPROM | LGA 218PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux | MYD-LMX9131-8E1D-140-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×USB2.0、8×UART、8×I2C、2×I3C、2×CAN FD、8×SPI、2×SDIO |
| 多媒体接口 | RGB、Parallel CSI、3×SAI |
| 其他接口 | 12bit ADC、JTAG/SWD |

● 应用场景



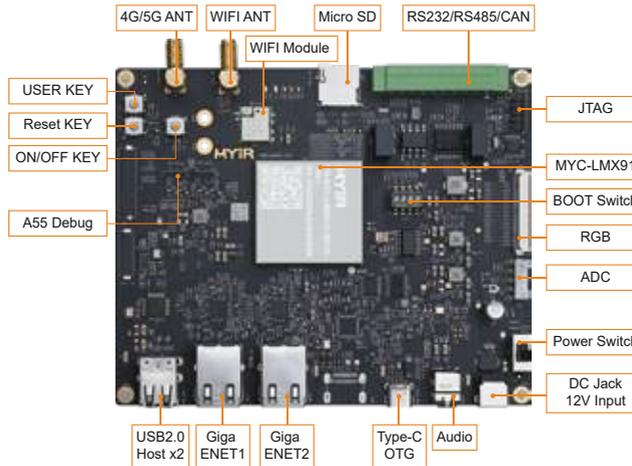
消费电子



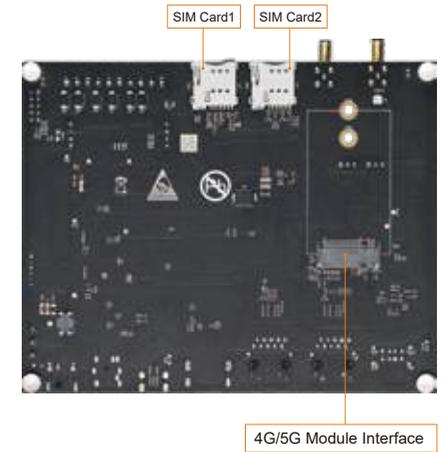
智能家居



HMI



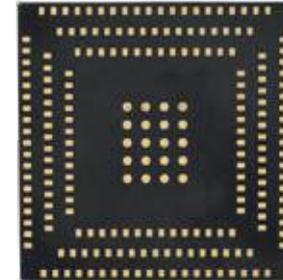
开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-LMX9X核心板

- 基于NXP i.MX 93处理器，2×Cortex-A55@1.7GHz+Cortex-M33@250MHz
- 集成0.5 TOPS NPU，赋能低成本轻量级AI应用
- 接口丰富：2路千兆以太网接口（1路支持TSN）、2路 CAN FD、8路UART、8路I2C、8路SPI
- LGA封装，218PIN；工业级：-40°C~+85°C，尺寸37×39mm；系统Linux、Debian



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|-----------------|---|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------|-----------------|------------------------|
| MYC-LMX9352-8E1D-170-I | MIMX9352CVVXMAB | 2×Cortex-A55@1.7GHz+ Cortex-M33@250MHz | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 256KBit EEPROM | LGA 218PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux Debian | MYD-LMX9352-8E1D-170-I |
| MYC-LMX9352-8E2D-170-I | | | 2GB LPDDR4 | | | | | | | MYD-LMX9352-8E2D-170-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMI, 2×CAN FD, 2×USB2.0, 8×UART, 8×SPI, 8×I2C, 2×I3C |
| 多媒体接口 | MIPI DSI, LVDS, RGB, MIPI CSI, Parallel CSI, 3×SAI |
| 其他接口 | 12bit 4ch ADC, JTAG |

● 应用场景



充电桩



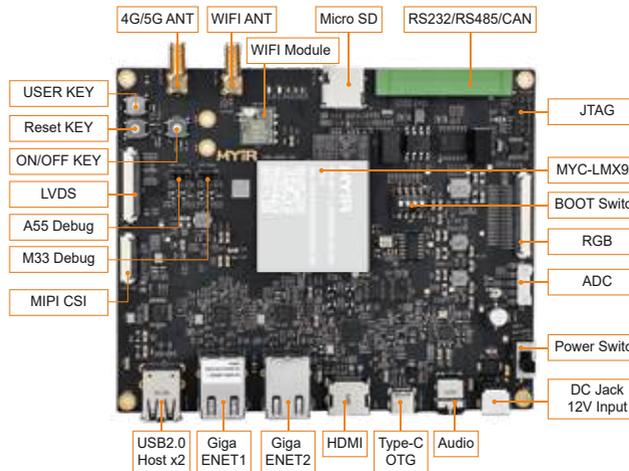
运动控制器



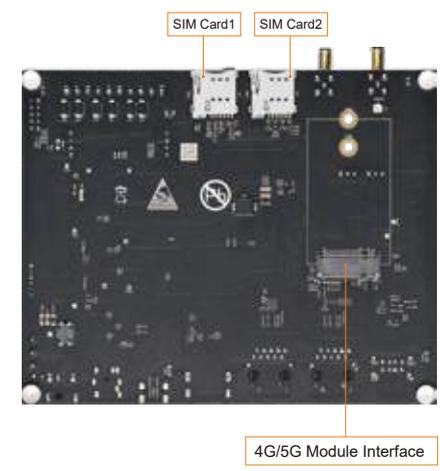
工程机械



医疗器械



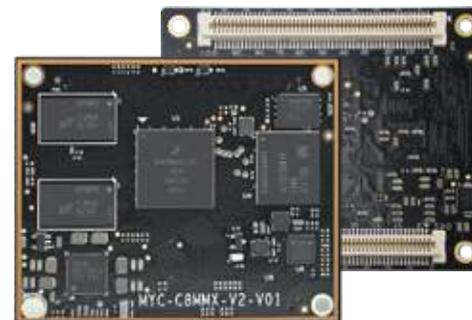
开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-C8MMX-V2核心板

- 基于NXP i.MX8M Mini处理器，更高效的任務处理，内核4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M4@400MHz
- 主要应用于智能充电桩、人机互动、泛在电力物联网、工业及医疗、智能交通、智慧消防、智慧城市等领域
- 接口丰富：千兆以太网接口、2×USB2.0接口、PCIE2.0接口、4×UART、3×SPI、3×I2C
- B2B封装，200PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸49×60mm；系统Linux、Ubuntu、Android



扫一扫了解更多参数

产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|--------------------------|-----------------|--|----------|----------|---------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | MIMX8MM6DVTLZAA | 4×Cortex-A53@1.8GHz +Cortex-M4@400MHz | 2GB DDR4 | 8GB eMMC | Ethernet PHY 32MB QSPI FLASH | B2B 200PIN | 0°C~+70°C | 49×60mm | Linux Ubuntu Android | MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C |
| MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MIMX8MM6CVTKZAA | 4×Cortex-A53@1.6GHz +Cortex-M4@400MHz | | | | | -40°C~+85°C | | | MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I |

核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | RGMII、PCIE2.0、2×USB2.0、4×UART、3×SPI、3×I2C |
| 多媒体接口 | MIPI DSI、MIPI CSI、5×SAI |
| 其他接口 | JTAG |

应用场景



商业HMI



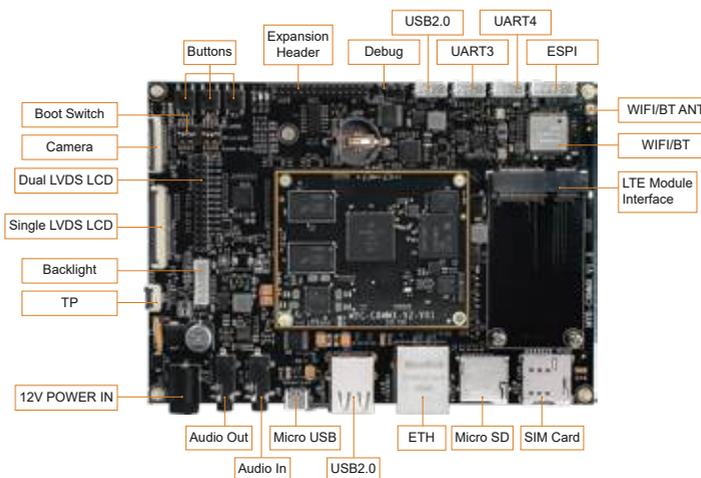
医疗器械



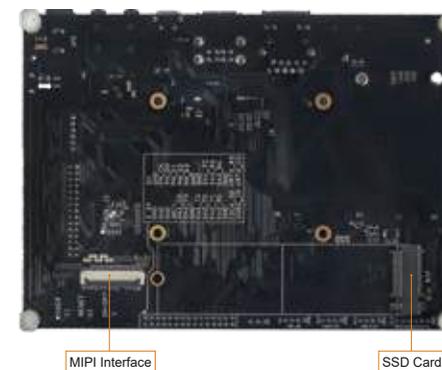
工业控制



人工智能



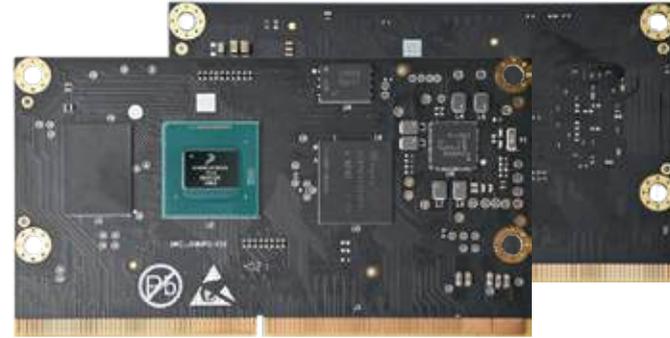
开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-JX8MPQ核心板

- 基于NXP i.MX 8M Plus处理器，2.3 TOPS算力，内核4×Cortex-A53@1.6GHz+Cortex-M7@800MHz
- 800MHz音频DSP、双摄像头（ISP）、3D GPU、AI相关软件DEMO丰富
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN FD接口、2路USB3.0接口、4路UART接口、3路SPI、6路I2C
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×82mm；系统Linux、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-----------------|--|------------|----------|-----------------|------------|-------------|---------|-------|-----------------------|
| MYC-JX8MPQ-8E2D-160-I | MIMX8ML8CVNKZAB | 4×Cortex-A53@1.6GHz +Cortex-M7@800MHz | 2GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 32MB QSPI FLASH | MXM 314PIN | -40°C~+85°C | 45×82mm | Linux | MYD-JX8MPQ-8E2D-160-I |
| MYC-JX8MPQ-8E4D-160-I | | | 4GB LPDDR4 | | | | | | | MYD-JX8MPQ-8E4D-160-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RGMII、PCIE3.0、2×USB3.0、2×CAN FD、4×UART、3×SPI、6×I2C |
| 多媒体接口 | HDMI、MIPI-DSI、LVDS、2×MIPI CSI、6×SAI |
| 其他接口 | JTAG |

● 应用场景



HMI



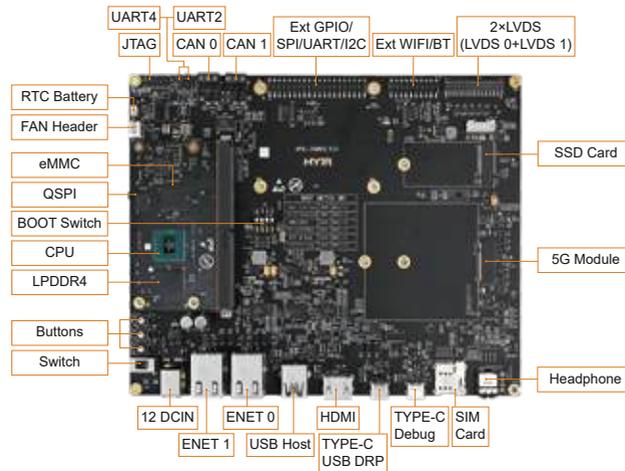
高性能AI设备



工业计算机



边缘计算



开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-J1028X核心板

- 基于NXP LS1028A处理器，内核 2×Cortex-A72@1.5GHz
- 接口丰富：6路千兆以太网接口（支持TSN）、2个USB3.0接口、2路CAN FD、6路UART、3路SPI、1路SATA 3.0
- 支持DP显示，可支持DP1.3和eDP1.4，显示分辨率高达4K@60FPS
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×82mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|
| MYC-J1028N-8E2D-150-I | LS1028AXN7PQA | 2×Cortex-A72@1.5GHz | 2GB DDR4 | 8GB eMMC | 32Kbit EEPROM | MXM 314PIN | -40°C~+85°C | 45×82mm | Linux Ubuntu | MYD-J1028N-8E2D-150-I |

核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | SGMII、QSGMII、RGMII、2×PCIE3.0、SATA 3.0、2×USB3.0、2×CAN FD、6×UART、3×SPI、8×I2C |
| 多媒体接口 | eDP、6×SAI |
| 其他接口 | JTAG |

应用场景



汽车电子



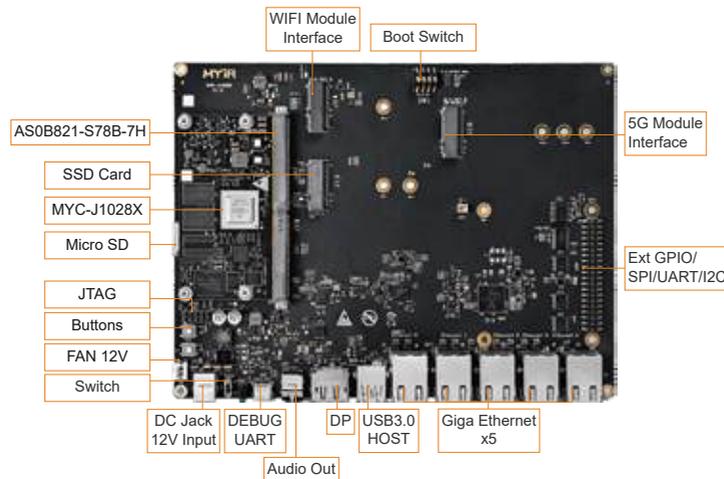
工业路由器



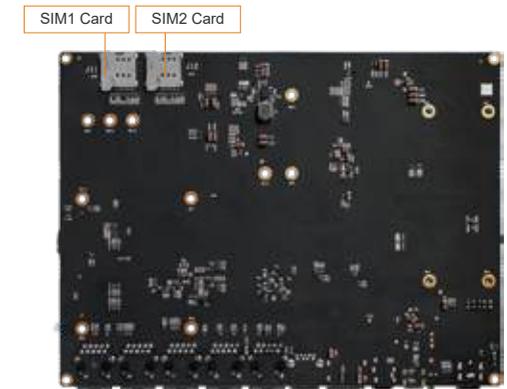
工业控制



边缘计算



开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP & AMD | MYC-JX8MMA7核心板

- CPU集成i.MX 8M Mini+ARTIX7处理器，内核4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M4@400MHz
- 二合一成本优势明显，高性能的ARM MPU+多媒体能力，良好LINUX UI界面的无缝交互
- 满足高速数据采集需求，ARM与FPGA之间采用PCIE高速通信，支持200~300MB/S的通信能力
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×82mm；系统Linux



● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|--------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------|---------|-------|--------------------------------|
| MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I | ARM: MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I | 4×Cortex-A53@1.6GHz+ Cortex-M4@400MHz FPGA: 23K | ARM: 2GB LPDDR4 | ARM: 8GB eMMC | 32MB QSPI FLASH | MXM 314PIN | -40°C~+85°C | 45×82mm | Linux | MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
| MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C | ARM: MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C | 4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M4@400MHz FPGA: 23K | FPGA: 256MB DDR3 | FPGA: 32MB QSPI FLASH | | | 0°C~+70°C | | | MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | RGMII, 2×USB2.0, 4×UART, 2×SPI, 2×I2C, 3×GTP |
| 多媒体接口 | MIPI DSI, MIPI CSI, 3×SAI |
| 其他接口 | JTAG |

● 应用场景



数据采集



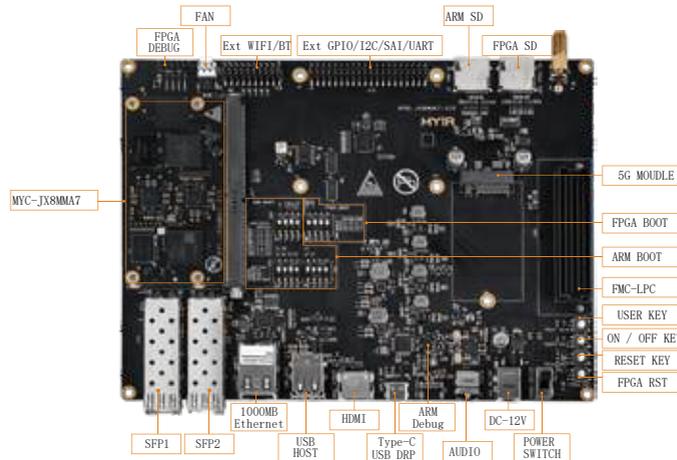
高端医疗



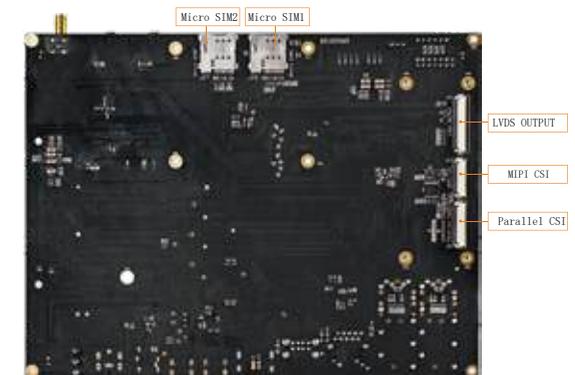
工业控制



工业网关



开发板正面标注图



开发板背面标注图

AMD | MYC-J7A100T核心板

- 采用Artix-7系列，可编程逻辑：101k Les, 126K DFF, 4.9Mb Bram, 240 DSP Slices
- 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V, LVDS_18, LVDS_25; 285x IOs
- 高速接口：4路6.6Gb/s GTP, 1路PCIE GEN2 X 4
- MXM封装，260PIN; 工业级：-40°C-85°C; 尺寸69.6×40mm



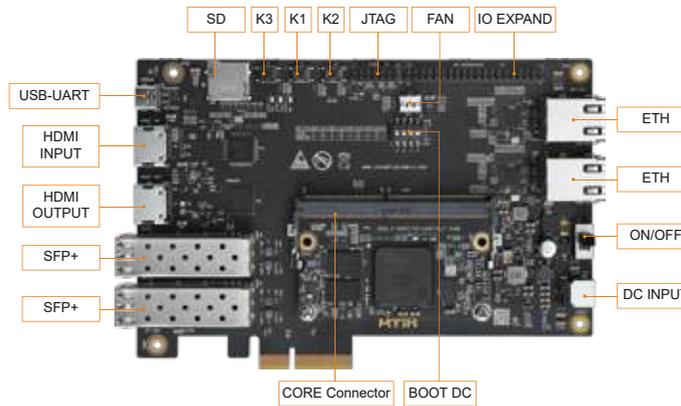
扫一扫了解更多参数

产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-------------------|-------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|----|-----------------------|
| MYC-J7A100T-32Q512D-I | XC7A100T-2FGG484I | - | 512MB DDR3 | 32MB QSPI | 32KB EEPROM | MXM 260PIN | -40°C-85°C | 69.6×40mm | - | MYD-J7A100T-32Q512D-I |

核心板外设资源

| 项目 | IO数量 | 描述 |
|---------|--------|-----------------|
| Bank 13 | 35 | 分bank引出178 HRIO |
| Bank 14 | 45 | |
| Bank 15 | 48 | |
| Bank 16 | 50 | |
| MGTP | 4 pair | 6.6Gb/s 串行收发器 |
| JTAG | 4 | JTAG 调试 |



开发板正面标注图



开发板背面标注图

应用场景



通信设备



图像处理



工业控制



医疗设备

AMD | MYC-C7Z010/20-V2核心板

- 基于AMD Zynq-7010/20高性能处理器，内核2×Cortex-A9@667/766MHz+Atrix 7 FPGA
- 1GBDDR, 4GB eMMC ,32MB QSPI flash; 极致选料与工艺标准,品质可靠
- 板载千兆以太网 PHY及USB PHY; 提供完善硬件参考&软件源码及教程，助力产品开发
- B2B封装，2×140PIN; 商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸75×55mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|--------------------------|-----------------|--|----------|----------|--|--------------|--------------------------|---------|-------|--------------------------|
| MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-I | xc7z010-1clg400 | 2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K) | 1GB DDR3 | 4GB eMMC | 32MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY | B2B 2×140PIN | -40°C~+85°C | 75×55mm | Linux | MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-I |
| MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-I | xc7z020-2clg400 | 2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K) | | | | | | | | MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-I |
| MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-C | xc7z010-1clg400 | 2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K) | | | | | MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-C | | | |
| MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-C | xc7z020-2clg400 | 2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K) | | | | | MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-C | | | |

● 核心板扩展信号

| | |
|----------|--|
| 通信接口 | RGMII、USB2.0、CAN、2×SPI、2x I2C、XADC |
| FPGA扩展IO | 可扩展管脚数量141PIN(FPGA_XC7020)、114PIN(FPGA_XC7010) |

● 应用场景



汽车行业



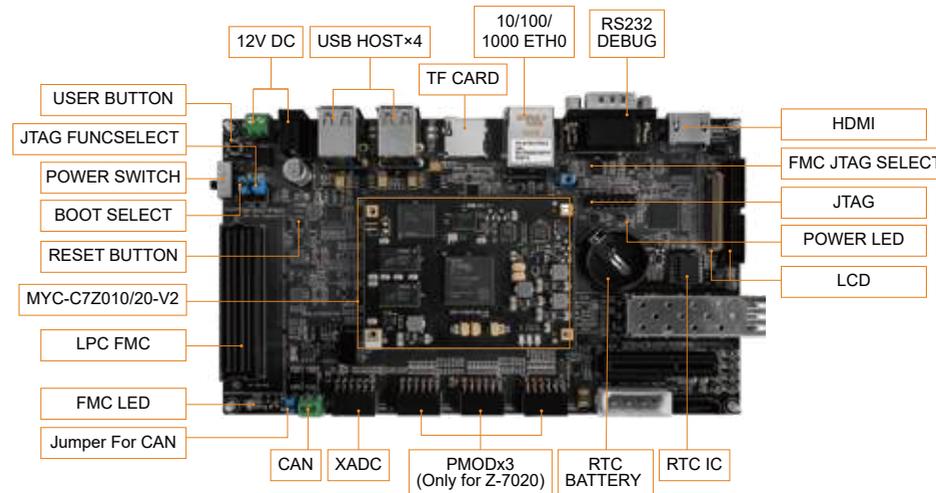
医疗器械



工业控制



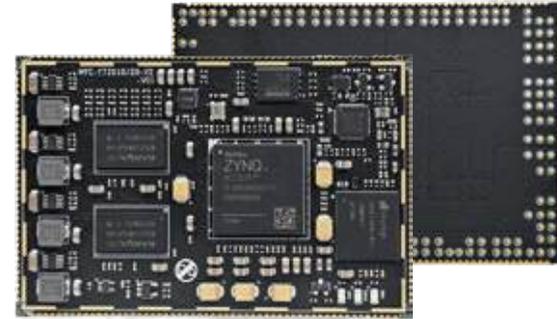
通信系统



开发板正面标注图

AMD | MYC-Y7Z010/20-V2核心板

- 基于AMD Zynq-7010/20高性能处理器，内核2×Cortex-A9@667/766MHz+Atrix 7 FPGA
- 512MB DDR, 4GB eMMC ,16MB QSPI flash; 极致选料与工艺标准,品质可靠
- 板载千兆以太网 PHY，提供完善硬件参考&软件源码及教程，助力产品开发
- LCC封装，180PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸75×50mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------------|-----------------|--|------------|----------|---------------------------------|------------|-------------|---------|-------|--------------------------|
| MYC-Y7Z010-V2-4E512D-667-I | xc7z010-1clg400 | 2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K) | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 16MB QSPI Flash Ethernet PHY | LCC 180PIN | -40°C~+85°C | 75×50mm | Linux | MYD-Y7Z010-V2-4E1D-667-I |
| MYC-Y7Z020-V2-4E512D-766-I | xc7z020-2clg400 | 2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K) | | | | | | | | MYD-Y7Z020-V2-4E1D-766-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 通信接口 | RGMII、USB2.0、CAN、2×SPI、2×I2C、JTAG |
| FPGA扩展IO | 可扩展管脚数量121PIN |

● 应用场景



汽车行业



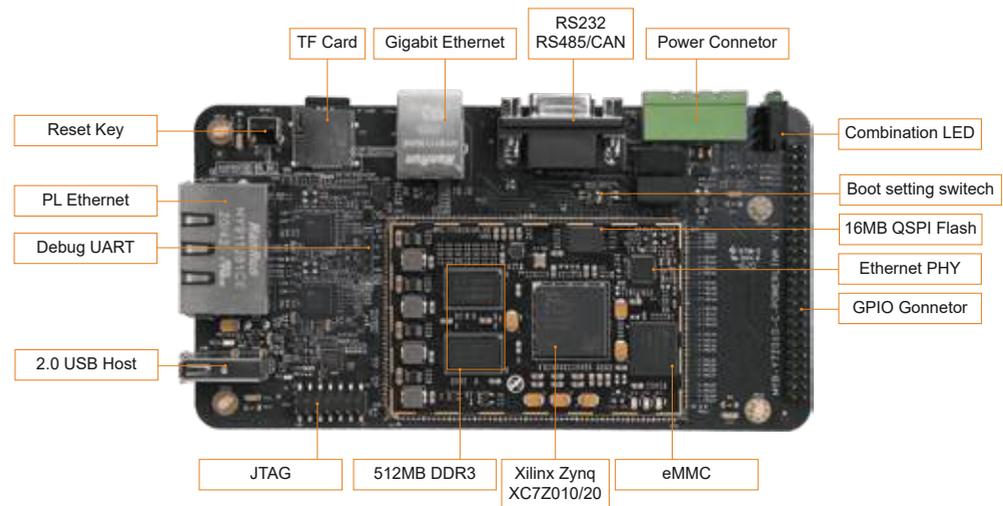
医疗器械



工业控制



人工智能



开发板正面标注图

AMD | MYC-C7Z015核心板

- 基于AMD Zynq-7015处理器、内核2×Cortex-A9@766MHz+Atrix 7 FPGA (74K) , 高性能高品质Zynq-7015计算平台
- 板载千兆以太网 PHY及USB PHY, 极致选料与工艺标准, 品质可靠
- 提供丰富的高速及通用接口, 为广泛应用提供设计参考
- B2B封装, 2×140PIN; 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸75×55mm; 系统Linux



扫一扫了解更多参数

产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-----------------|--|----------|----------|--|--------------|-------------|---------|-------|-----------------------|
| MYC-C7Z015-4E1D-766-I | xc7z015-2clg485 | 2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (74K) | 1GB DDR3 | 4GB eMMC | 32MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY | B2B 2×140PIN | -40°C~+85°C | 75×55mm | Linux | MYD-C7Z015-4E1D-766-I |

核心板扩展信号

| | |
|----------|---|
| 通信接口 | RGMII、USB2.0、CAN、2×SPI、2×I2C、2×XADC、SFP、PCIE、SATA |
| FPGA扩展IO | 可扩展管脚数量137PIN(FPGA_XC7015) |

应用场景



汽车行业



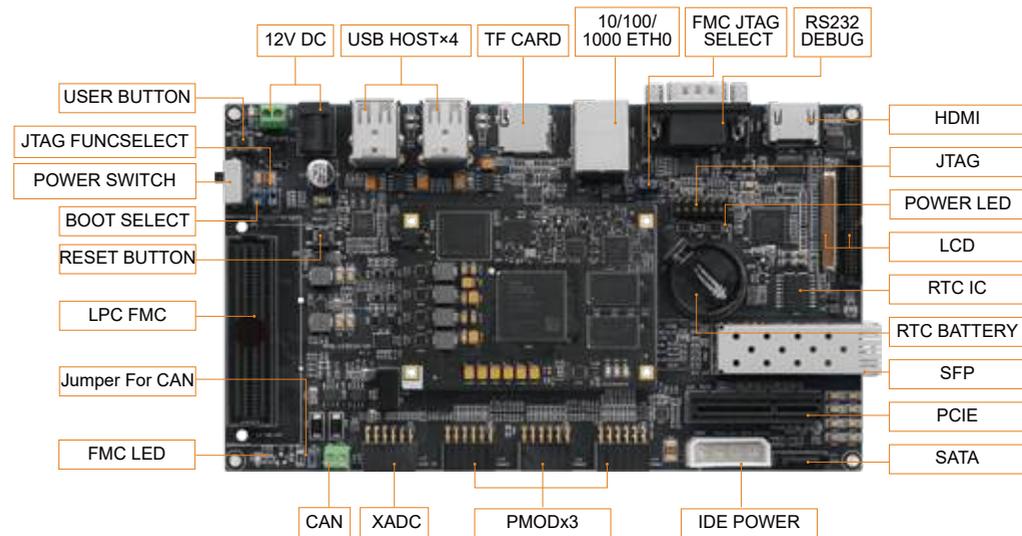
医疗器械



工业控制



通信系统



开发板正面标注图

AMD | MYC-CZU1EG/3EG-V3核心板

- 基于AMD XCZU1EG/3EG SOC FPGA，集成APU,RPU,GPU,PL（自适应计算引擎）
- TSMC 16nm Finfet工艺，超强性能，超低功耗
- 板载USB PHY，Ethernet PHY
- B2B 320 PIN，商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸60x52 mm；系统 Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|---------------------------|-------------------|--|----------|----------|---|-------------------|-----------|---------|-------|------------------------|
| MYC-CZU1EG-V3-8E4D-1333-C | XCZU1EG-2SFVC784I | ARM:4xA55@ 1.33GHz + R5F@533MHz + UltraScale+ FPGA 81K + Mali400MP2@667MHz | 4GB DDR4 | 8GB eMMC | 128MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY | 高速B2B 2x160PIN | 0°C~+70°C | 60x52mm | Linux | MYD-CZU1EG-8E4D-1333-C |
| -40°C~+85°C | | | | | | | - | | | |
| MYC-CZU3EG-V3-8E4D-1200-C | XCZU3EG-1SFVC784 | ARM:4xA53@1200MHz+2xR5F@533MHz + UltraScale+ FPGA 154K + Mali400MP2@667MHz | 4GB DDR4 | 8GB eMMC | 128MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY | 高速B2B 2x160PIN | 0°C~+70°C | | | MYD-CZU3EG-8E4D-1200-C |
| -40°C~+85°C | | | | | | | - | | | |

● 核心板扩展信号

| | |
|----------|---|
| 通信接口 | 2×ETH、2×CAN 2.0B、2×USB 2.0、2×UART、2×SPI、2×I2C、 4 x GTR |
| FPGA扩展IO | 156PIN FPGA HP IO (1.8V) |

● 应用场景



边缘智能



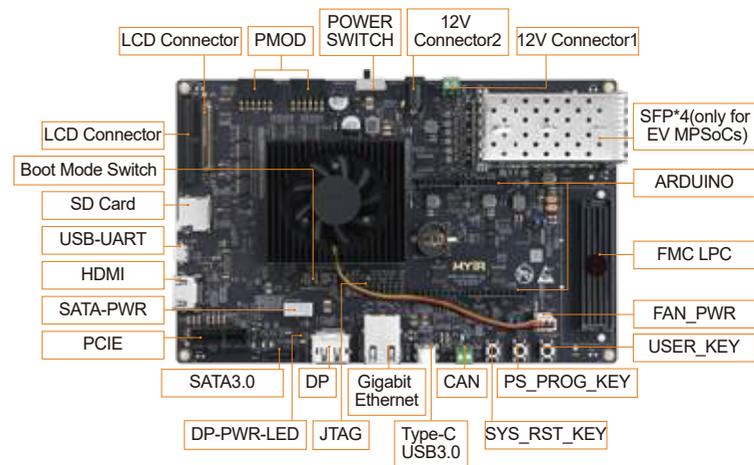
医疗器械



工业控制



自动驾驶



AMD | MYC-CZU4EV/5EV-V2核心板

- 基于AMD XCZU4EV/XCZU5EV处理器, ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz+ UltraScale+ FPGA
- 每瓦性能提升5倍; 4GB DDR4 (64bit, 2400MHZ), 4GB eMMC, 128MB QSPI flash
- 搭载DPU AI引擎, 可提供强大AI计算能力, 结合DNNDK工具链, 为AI应用落地提供完整支撑
- B2B封装, 2×160PIN; 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸60×52mm; 系统Linux



● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-------------------------------|------------------|---|----------|----------|---|-------------------|-------------|---------|-------|---|
| MYC-CZU4EV-V2-4E4D-1200-I-FAN | XCZU4EV-2SFVC784 | ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz + UltraScale+ FPGA 192K | 4GB DDR4 | 4GB eMMC | 128MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY | 高速B2B 2×160PIN | -40°C~+85°C | 60×52mm | Linux | MYD-CZU4EV-V2-4E4D-1200-C (采用工业级核心板) |
| MYC-CZU5EV-V2-4E4D-1200-I-FAN | XCZU5EV-2SFVC784 | ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz + UltraScale+ FPGA 256K | | | | | | | | MYD-CZU5EV-V2-4E4D-1200-C (采用工业级核心板) |

● 核心板扩展信号

| | |
|----------|--|
| 通信接口 | RGMII、CAN、USB3.0、USB_UART、2×PMOD、PCIE2.0、DP SATA3.0、4×SFP |
| FPGA扩展IO | 可扩展管脚数量156PIN(FPGA) |

● 应用场景



数据中心



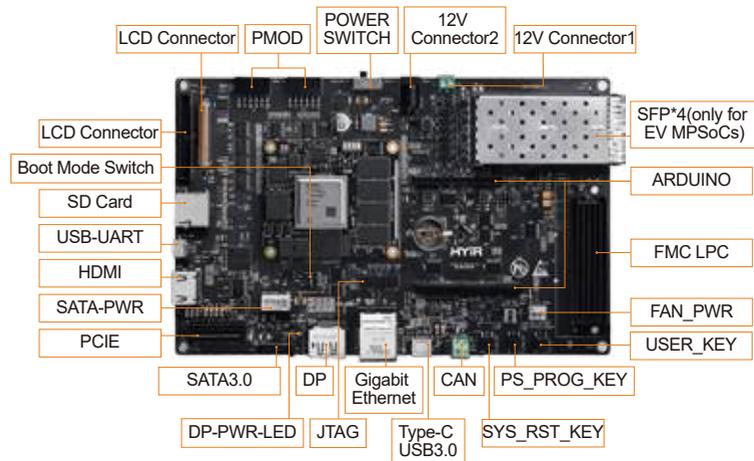
医疗器械



工业控制

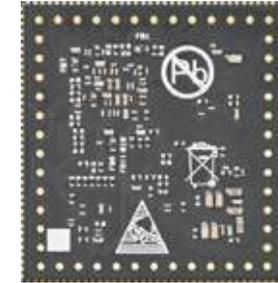


自动驾驶



RENESAS | MYC-YG2UL核心板

- 基于RZ/G2UL处理器，通用64位工业MPU；内核Cortex-A55@1.0GHz +Cortex-M33@200MHz
- 16位DDR3L/DDR4接口以及LCD控制器
- 接口丰富：摄像头输入、显示输出、USB2.0和千兆以太网
- LCC+LGA封装，190PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux、OpenWrt



扫一扫了解更多参数

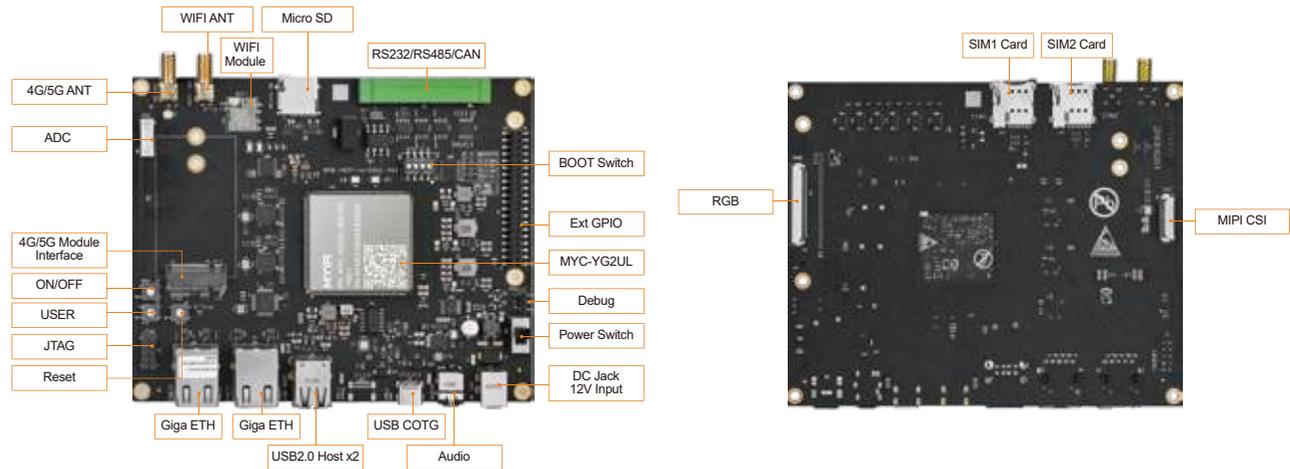
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|-----------------|---|------------|----------|---------------|----------------|-------------|---------|------------------|------------------------|
| MYC-YG2UL-4E512D-100-I | R9A07G043U11GBG | Cortex-A55@1.0GHz+ Cortex-M33@200MHz | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 32KBit EEPROM | LCC+LGA 190PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux OpenWrt | MYD-YG2UL-4E512D-100-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMII, 2×CAN FD, 2×USB2.0, 7×UART, 3×SPI, 4×I2C |
| 多媒体接口 | RGB, MIPI CSI, 4×SSI |
| 其他接口 | 12bit 2ch ADC, JTAG |

● 应用场景

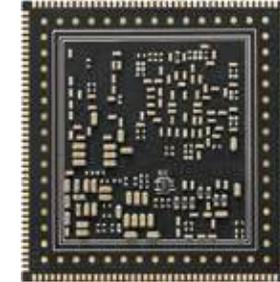


开发板正面标注图

开发板背面标注图

RENESAS | MYC-YG2LX核心板

- 基于瑞萨高性价比RZ/G2L处理器，2×Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz，满足高性能和实时性需求
- 具有极强的泛用性和易用性；丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/MIPI-CSI/Parallel CSI
- 集成Arm Mali-G31 3D GPU，VPU支持H.264 1920*1080@30FPS视频编解码
- LCC+LGA封装，222PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

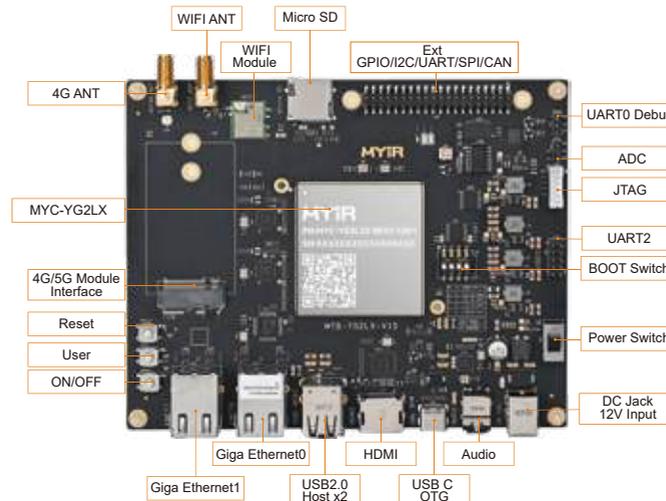
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-----------------|---|----------|----------|----------------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|
| MYC-YG2L23-8E1D-120-I | R9A07G044L23GBG | 2×Cortex-A55@1.2GHz+ Cortex-M33@200MHz | 1GB DDR4 | 8GB eMMC | 256KBit EEPROM | LCC+LGA 222PIN | -40°C~+85°C | 43×45mm | Linux Ubuntu | MYD-YG2L23-8E1D-120-I |
| MYC-YG2L23-8E2D-120-I | | | 2GB DDR4 | | | | | | | MYD-YG2L23-8E2D-120-I |

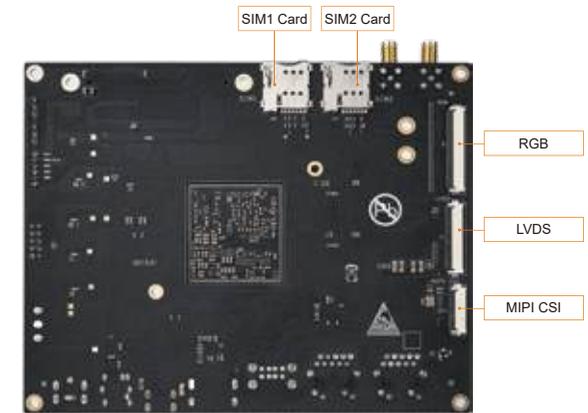
● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×CAN FD、2×USB2.0、7×UART、3×SPI、4×I2C |
| 多媒体接口 | RGB、MIPI DSI、Parallel CSI、MIPI CSI、4×SSI、SRC |
| 其他接口 | 12bit 8ch ADC、JTAG |

● 应用场景



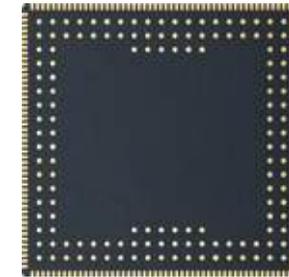
开发板正面标注图



开发板背面标注图

RENESAS | MYC-YT2HX核心板

- 基于瑞萨RZ/T2H处理器，4×Cortex-A55@1.2GHz+2×Cortex-R52@1.0GHz
- RZ/T2H驱控一体单芯片方案，CA55核做控制，CR52核做驱动，优于工业控制传统主站从站双芯片方案
- 支持多种协议，EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP和下一代TSN，并且配备编码器接口，可支持各种编码器协议
- LCC+LGA 336PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸50x52mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

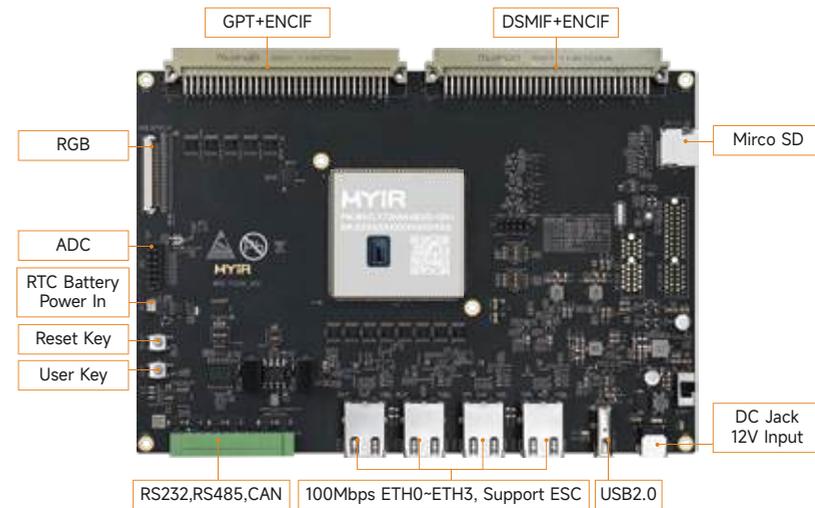
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|--------|---|------------|----------|-----------------|----------------|-------------|---------|-------|-----------------------|
| MYC-YT2H44-8E2D-120-I | RZ/T2H | 4×Cortex-A55@1.2GHz + 2×Cortex-R52@1GHz | 2GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 16MB QSPI FLASH | LCC+LGA 336PIN | -40°C~+85°C | 50x52mm | Linux | MYD-YT2H44-8E2D-120-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | RGMII、3×RMII、ENCIF、USB2.0、2×CAN FD、2×I2C、4×SPI、SDHI、30×DSMIF、PCIE3.0、18×SCI、External bus 32bit、JTAG/SWD、XSPI |
| 多媒体接口 | RGB888 |
| 其他接口 | ADC |

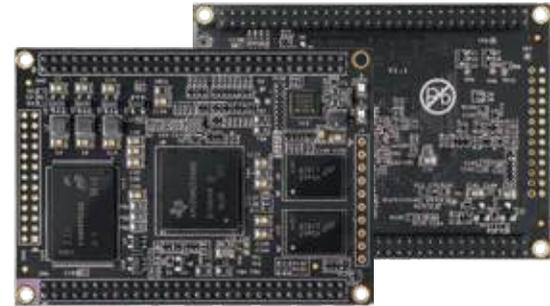
● 应用场景



开发板正面标注图

TEXAS INSTRUMENTS | MYC-C335X-V4核心板

- 基于TI AM335X处理器，兼容性强，易拓展，内核Cortex-A8@800MHz/1.0GHz
- 主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、消费类医疗器械以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等产品
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口
- DIP封装，2×60PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸70×50mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------|-------|-----------------------------|
| MYC-C3352-V4-256N256D-80-I | AM3352BZCZD80 | Cortex-A8@800MHz | 256MB DDR3 | 256MB Nand FLASH | Ethernet PHY 32Kbit EEPROM | DIP 2×60PIN | -40°C~+85°C | 70×50mm | Linux | MYD-C3352-V4-256N256D-80-I |
| MYC-C3352-V4-512N512D-80-I | | | 512MB DDR3 | 512MB Nand FLASH | | | 0°C~+70°C | | | MYD-C3352-V4-512N512D-80-I |
| MYC-C3352-V4-512N512D-80-C | | | 256MB DDR3 | 256MB Nand FLASH | | | -40°C~+85°C | | | MYD-C3352-V4-512N512D-80-C |
| MYC-C3358-V4-256N256D-100-I | AM3358BZCZA100 | Cortex-A8@1.0GHz | 256MB DDR3 | 256MB Nand FLASH | | | 0°C~+70°C | | | MYD-C3358-V4-256N256D-100-I |
| MYC-C3358-V4-512N512D-100-I | | | 512MB DDR3 | 512MB Nand FLASH | | | -40°C~+85°C | | | MYD-C3358-V4-512N512D-100-I |
| MYC-C3358-V4-512N512D-100-C | | | 512MB DDR3 | 512MB Nand FLASH | | | 0°C~+70°C | | | MYD-C3358-V4-512N512D-100-C |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×CAN、2×USB2.0、6×UART、2×SPI、3×I2C |
| 多媒体接口 | RGB、2×McASP |
| 其他接口 | 12bit 8ch ADC、JTAG |

● 应用场景

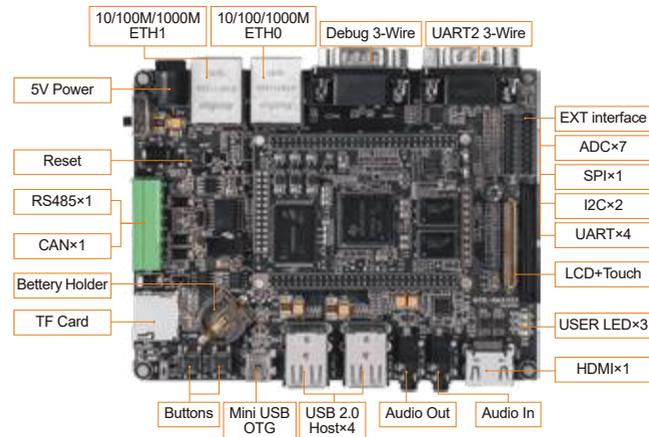


充电桩计费控制

医疗器械

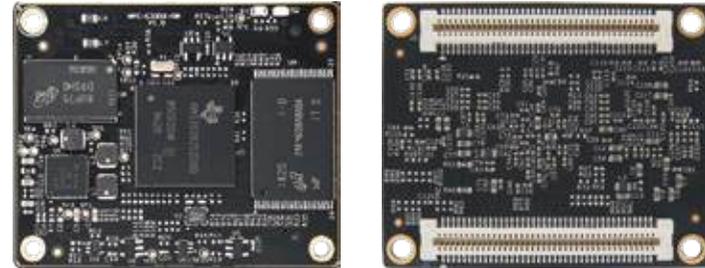
工业领域

游戏外设



开发板正面标注图

- 基于TI AM335x处理器，内核 Cortex-A8@800MHz
- 支持光口，WiFi/蓝牙，4G LTE等高速通信应用接口；提供Linux以及MYIR MEasy IOT Demo软件支持
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口
- B2B封装，2×80PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸50×40mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------|----------------------------|
| MYC-C3354-256N256D-80-I-GW | AM3354BZCZD80 | Cortex-A8@800MHz | 256MB DDR3L | 256MB Nand Flash | 32kbit EEPROM | B2B 2×80PIN | -40°C~+85°C | 50×40mm | Linux | MYD-C3354-256N256D-80-I-GW |
| MYC-C3354-4E512D-80-I-GW | | | 512MB DDR3L | 4GB eMMC | | | | | | MYD-C3354-4E512D-80-I-GW |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×CAN、2×USB2.0、6×UART、2×SPI、3×I2C |
| 多媒体接口 | RGB、2×McASP |
| 其他接口 | 12bit 8ch ADC、JTAG |

● 应用场景



工业网关



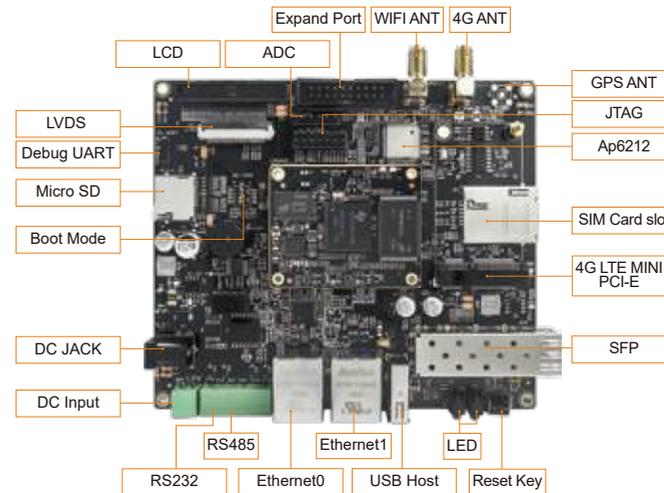
HMI



医疗器械



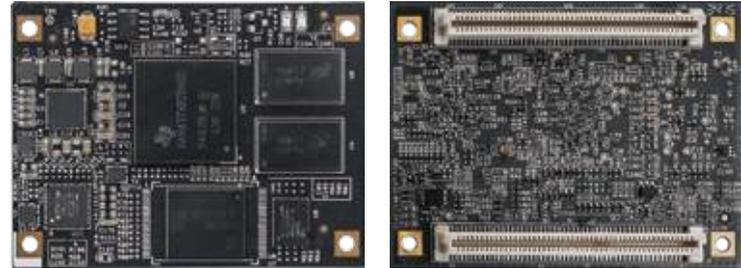
工业控制



开发板正面标注图

MYC-C437X-V2核心板

- 基于TI AM437x处理器，可应用导航设备、条形扫描仪等产品，内核Cortex-A9@1.0GHz
- 基于高性能ARM Cortex-A9 32位RISC为核心，运行速度最高达1GHz，并提供3D图形加速和摄像机并行端口
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路USB2.0接口、6路UART、2路CAN、2路SPI、3路I2C
- B2B封装，200PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×60mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|---------------------------|----------------|------------------|------------|----------|--------------------------------|------------|-------------|---------|-------|---------------------------|
| MYC-C4378-V2-4E512D-100-C | AM4378BZDND100 | Cortex-A9@1.0GHz | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | Ethernet PHY 256Kbit EEPROM | B2B 200PIN | 0°C~+70°C | 45×60mm | Linux | MYD-C4378-V2-4E512D-100-C |
| MYC-C4378-V2-4E512D-100-I | | | | | | | -40°C~+85°C | | | MYD-C4378-V2-4E512D-100-I |
| MYC-C4377-V2-4E512D-100-I | AM4377BZDND100 | - | - | - | - | - | - | | | - |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RGMII, 2×CAN, 2×USB2.0, 6×UART, 2×SPI, 3×I2C |
| 多媒体接口 | RGB, 2×Parallel CSI, 2×McASP |
| 其他接口 | 2×12bit 8ch ADC, JTAG |

● 应用场景



工业HMI



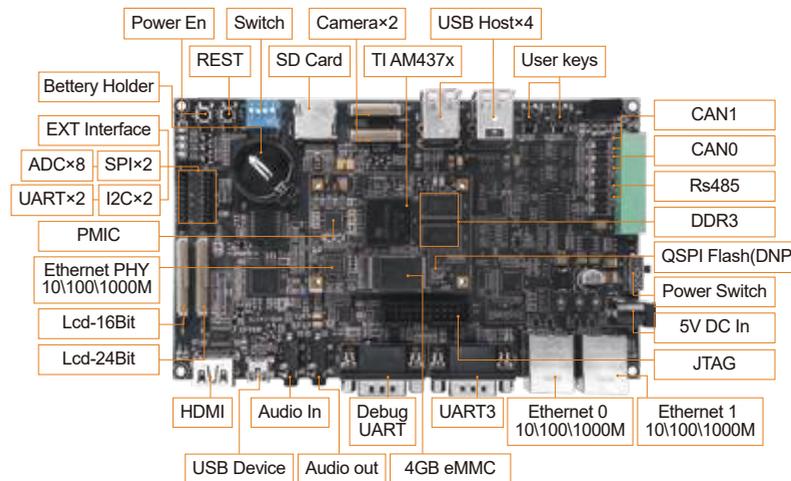
医疗器械



工业领域



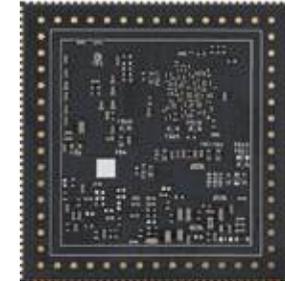
扫码仪



开发板正面标注图

MYC-YM62X核心板

- AM62x是TI在智能工控领域高性能、超高效处理器，内核1/2/4×Cortex-A53@1.4GHz+Cortex-M4F@400MHz
- 3D GPU图形加速器，支持OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2图形加速引擎，支持双屏异显，支持1080P高清显示
- 接口丰富：2路显示控制器、2个千兆以太网、3路原生CAN FD、支持并行总线GPMC
- LCC+LGA封装，222PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、Debian



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他存储 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-----------------|---|----------|----------|---------------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|
| MYC-YM6254-8E2D-140-I | AM6254ATCGGAALW | 4×Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M4F@400MHz | 2GB DDR4 | | | | | | | MYD-YM6254-8E2D-140-I |
| MYC-YM6252-8E1D-140-I | AM6252ATCGGAALW | 2×Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M4F@400MHz | 1GB DDR4 | 8GB eMMC | 32Kbit EEPROM | LCC+LGA 222PIN | -40°C~+85°C | 43×45mm | Linux Debian | MYD-YM6252-8E1D-140-I |
| MYC-YM6231-8E1D-140-I | AM6231ASGGGAALW | Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M4F@400MHz | 1GB DDR4 | | | | | | | MYD-YM6231-8E1D-140-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×USB 2.0、9×UART、3×CAN FD、4×I2C、5×SPI |
| 多媒体接口 | 2×LVDS、1×RGB、1×MIPI CSI、3×MCASP |
| 其他接口 | 1×GPMC、1×JTAG |

● 应用场景



工业HMI



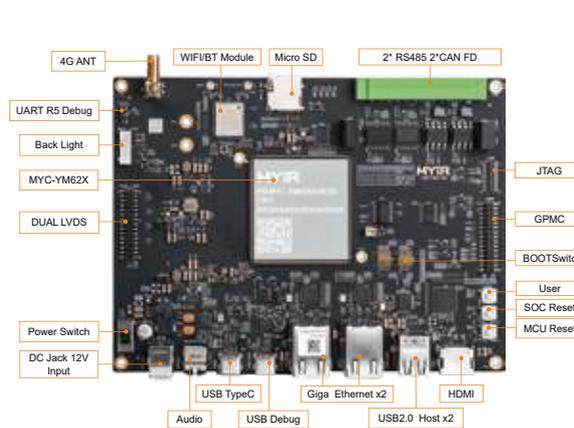
医疗器械



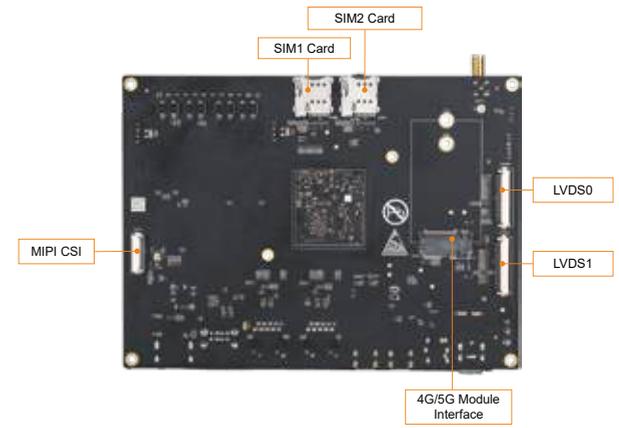
工业控制



能源电力



开发板正面标注图



开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-YT113i核心板

- 基于全志T113-i处理器，内核 2×Cortex-A7@1.2GHz+RISC-V@800MHz
- 100%国产物料，核心板采用高密度高速电路板设计，板卡采用8层高密度PCB设计，独立的接地信号层，无铅
- 接口丰富：1路千兆以太网、2路USB2.0、6路UART、2路CAN、8路PWM、1路GPADC、4路TPADC
- LCC+LGA封装，140+50PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| MYC-YT113i-4E256D-110-I | T113-i | 2×Cortex-A7@1.2G +RISC-V@800MHz | 256MB DDR3 | 4GB eMMC | 32Kbit EEPROM | LCC+LGA 140+50PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux | MYD-YT113i-4E256D-110-I |
| MYC-YT113i-4E512D-110-I | | | 512MB DDR3 | | | | | | | MYD-YT113i-4E512D-110-I |
| MYC-YT113i-8E512D-110-I | | | 1GB DDR3 | 8GB eMMC | | | | | | MYD-YT113i-8E512D-110-I |
| MYC-YT113i-8E1D-110-I | | | | MYD-YT113i-8E1D-110-I | | | | | | |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 千兆以太网、2×USB2.0、6×UART、2×CAN、SDIO、SPI、4×I2C、8×PWM |
| 多媒体接口 | MIPI DSI、RGB DSI、Dual link LVDS、CVBS OUT、Parallel CSI、2×I2S |

● 应用场景



商业显示



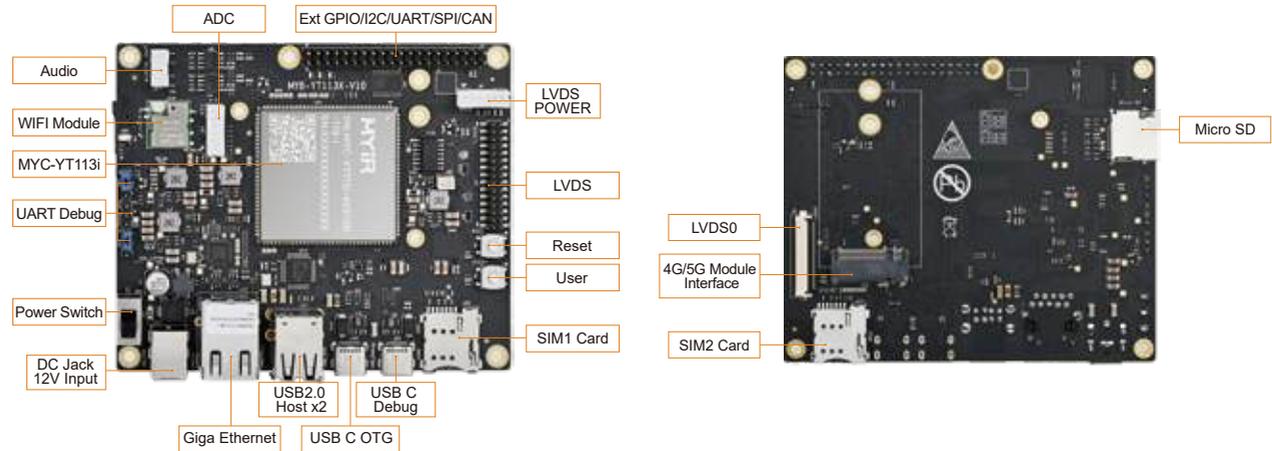
医疗器械



工业控制



能源电力



开发板正面标注图

开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-YT113X核心板

- 基于全志T113-S3入门级处理器，内核2×Cortex-A7@1.2GHz
- 适用于低成本网关产品和商业显示产品，具有丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS/Parallel CSI，支持1080P@60FPS
- 接口丰富：千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口
- LCC封装，140PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------------|---------|--------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------|-------|----------------------------|
| MYC-YT113S3-256N128D-110-I | T113-S3 | 2×Cortex-A7@1.2GHz | 128MB DDR3 | 256MB Nand Flash | 32Kbit EEPROM | LCC 140PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux | MYD-YT113S3-256N128D-110-I |
| MYC-YT113S3-4E128D-110-I | | | | 4GB eMMC | | | | | | MYD-YT113S3-4E128D-110-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 千兆以太网、2×USB2.0、6×UART、2×CAN、SDIO、2×SPI、4×I2C、8×PWM |
| 多媒体接口 | MIPI DSI、RGB DSI、2×LVDS、Parallel CSI、2×I2S |

● 应用场景



商业显示



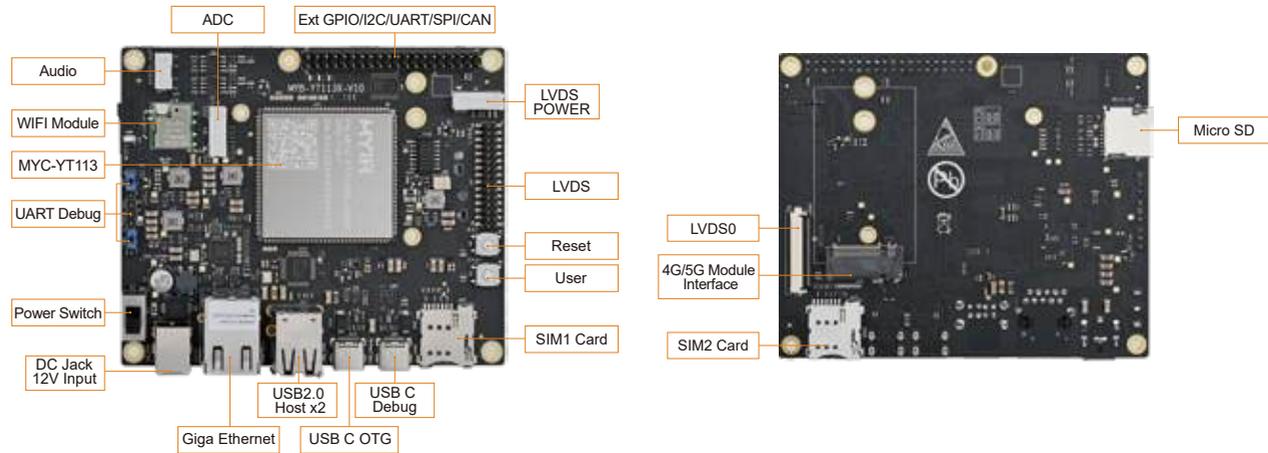
医疗器械



工业控制



能源电力

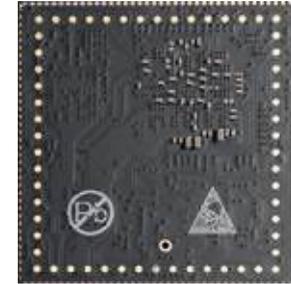


开发板正面标注图

开发板背面标注图

ALLWINNER | MYC-YT507H核心板

- 基于全志T507-H处理器，四核Cortex-A53@1.5GHz，符合汽车AEC-Q100测试要求
- 支持4K@60FPS H.265视频解码，支持4K@25FPS H.264视频编码
- 可支持双屏同显、双屏异显，支持MIPI CSI、DVP摄像头输入；
- LCC+LGA封装，222PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、Android、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-------|---------------------|-------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| MYC-YT507H-8E1D-150-C | T507H | 4×Cortex-A53@1.5GHz | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 32Kbit EEPROM | LCC+LGA 222PIN | 0°C~+70°C | 43×45mm | Linux Android Ubuntu | MYD-YT507H-8E1D-150-C |
| MYC-YT507H-8E1D-150-I | | | | | | | -40°C~+85°C | | | MYD-YT507H-8E1D-150-I |
| MYC-YT507H-8E2D-150-C | | | 0°C~+70°C | | | | MYD-YT507H-8E2D-150-C | | | |
| MYC-YT507H-8E2D-150-I | | | -40°C~+85°C | | | | MYD-YT507H-8E2D-150-I | | | |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 千兆以太网、4×USB2.0、6×UART、2×SDIO、2×SPI、4×I2C、6×PWM、5×ADC |
| 多媒体接口 | HDMI、2×LVDS、RGB24、TV CVBS、Parallel CSI、MIPI CSI、3×I2S、SPDIF |

● 应用场景



商业显示



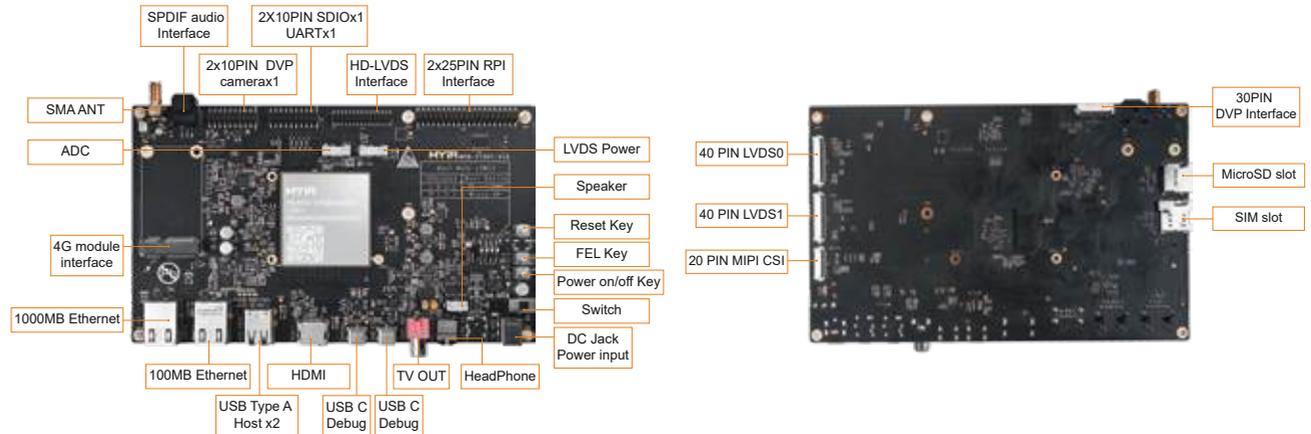
医疗器械



工业控制



智能终端

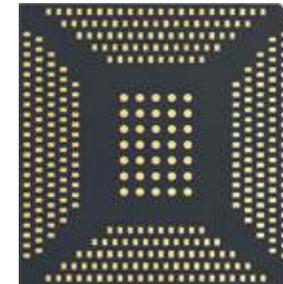


开发板正面标注图

开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-LT536核心板

- 基于全志T536处理器，4×Cortex-A55@1.6GHz+RISCV@600MHz，
- 原生4路CAN FD接口，17路UART接口，Localbus接口，PCIE2.0，USB3.1，
- 2Tops NPU可选(T536MX-CEN2)、Graphic 2D，助力轻量级AI边缘计算应用
- LGA 381PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

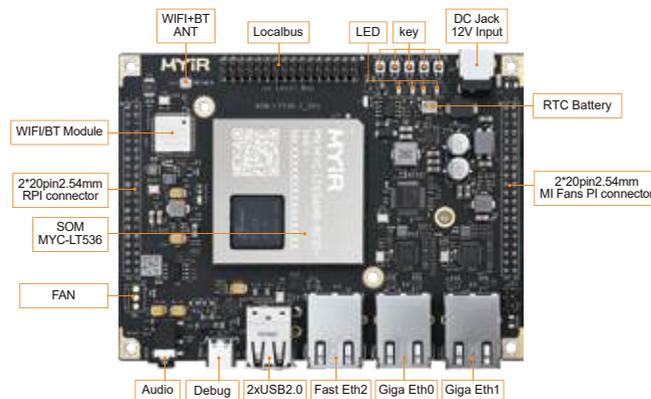
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|--------------------------|-------------|---|------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------|-------|-----------------------------|
| MYC-LT536ME-8E1D-160-I | T536MX-CEX | 4×Cortex-A55@1.6GHz+RISCV@600MHz | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 32KBit EEPROM | LGA 381PIN | -40°C~+85°C | 43×45 mm | Linux | MYD-LT536ME-8E1D-160-I-GK |
| MYC-LT536ME-16E2D-160-I | | | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | | | | | | MYD-LT536ME-16E2D-160-I-GK |
| MYC-LT536MN2-32E4D-160-I | T536MX-CEN2 | 4×Cortex-A55@1.6GHz+RISCV@600MHz, 2Tops NPU | 4GB LPDDR4 | 32GB eMMC | | | | | | MYD-LT536MN2-32E4D-160-I-GK |

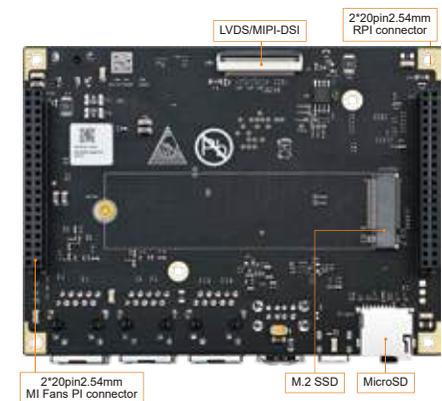
● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RGMII、USB3.1 DRD/PCIE2.0、2×USB2.0、Localbus 4×CAN FD、17×UART |
| 多媒体接口 | LVDS、MIPI DSI、Parallel DSI、4×I2S |
| 其他接口 | 9×I2C、34×PWM、6×SPI、SDIO、26×12bit GPADC |

● 应用场景



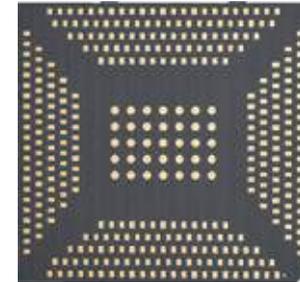
开发板正面标注图



开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-LT527核心板

- 基于全志T527处理器，4×Cortex-A55@1.8GHz+4×Cortex-A55@1.4GHz，RISC-V@200MHz
- 多媒体功能强大：具备G57 GPU、4K编解码VPU、HiFi4 DSP，支持4-6路Camera
- 支持多种显示接口：HDMI、DP、LVDS、MIPI-DSI和RGB并口，支持4K+1080P双异显
- LGA封装，381PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、Android、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------------|---------|---|------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| MYC- LT527MN-16E2D-180-I-G | LT527MN | 4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz RISC-V@200MHz, 2Tops NPU | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | 32kbit EEPROM | LGA 381PIN | -40°C~+85°C | 43×45mm | Linux Android Ubuntu | - |
| MYC- LT527MN-32E4D-180-I-G | | | 4GB LPDDR4 | 32GB eMMC | | | | | | MYD- LT527MN-32E4D-180-I-GK |
| MYC- LT527M-16E2D-180-I-G | LT527M | 4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz RISC-V@200MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | | | | | | - |
| MYC- LT527M-8E1D-180-I-G | | | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | | | | | | - |
| MYC- LT527M-16E2D-180-E | | | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | | | | | | MYD- LT527M-16E2D-180-E |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×千兆以太网、USB3.0、2×USB2.0、1×PCIe2.1、10×UART 2×CAN2.0、3×SDIO、4×SPI、9×I2C、30×PWM、24×ADC |
| 多媒体接口 | HDMI2.0、eDP1.3、2×MIPI-DSI、2×Dual VLDS、Parallel DSI、 2×MIPI CSI、Parallel CSI、4×I2S/TDM |

● 应用场景



智慧商显



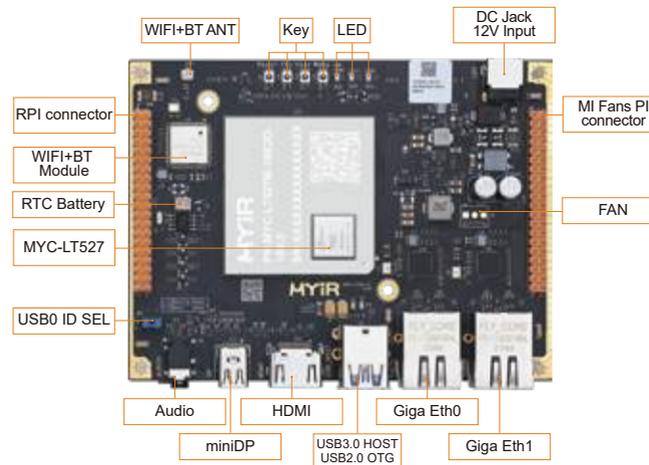
边缘智能盒子



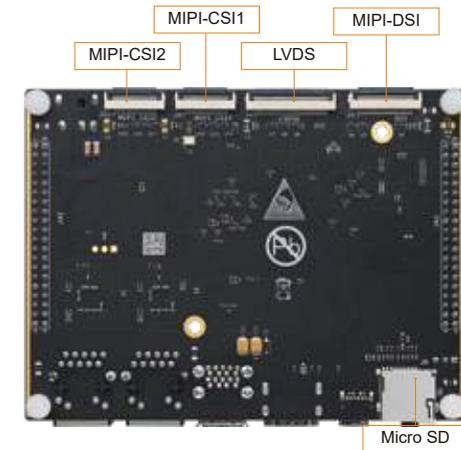
工业机器人



车载终端



开发板正面标注图



开发板背面标注图

MYC-JD9340核心板

- 基于国产芯驰D9处理器，内核4×Cortex-A55@1.6GHz+2×Cortex-R5@800MHz
- 低功耗：TSMC 车规工业16nm FinFET 先进工业保证相对较低的功耗；LINUX+RTOS系统，可以实现500ms冷启动显示
- 高可靠性：芯片结温支持范围从-40到125摄氏度，满足AEC-Q100车规级应用
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸82×45mm；系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|-----|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|---------|--|------------------------|
| MYC-JD9340-16E2D-160-I | D9 | 4×Cortex-A55@1.6GHz +2×Cortex-R5@800MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | E2PROM | MXM 314PIN | -40°C~+85°C | 82×45mm | Linux Android FreeRTOS Ubuntu | MYD-JD9340-16E2D-160-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×千兆以太网，支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC |
| 多媒体接口 | MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI |

● 应用场景



工业HMI



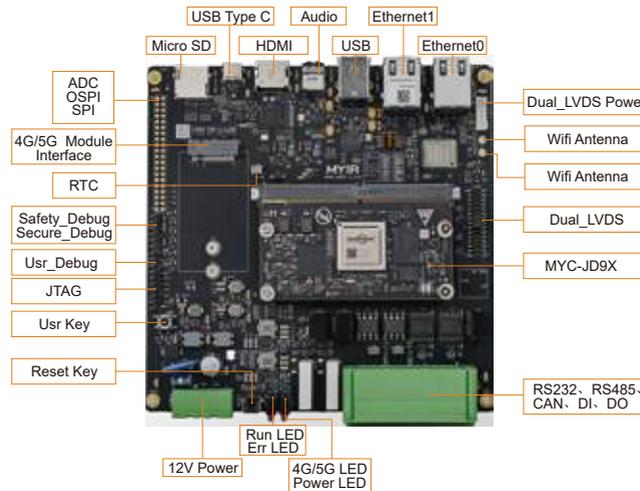
电力智能设备



工业机器人



轨道交通



开发板正面标注图



开发板背面标注图

MYC-JD9350核心板

- 基于国产芯驰D9-Plus处理器，内核5×Cortex-A55@1.6GHz+3×Cortex-R5@800MHz+0.8Tops NPU
- 安全加密：SIL4，ASILD级别功能安全独立域；硬件加密、国密认证、全场景ECC；支持100%国产物料定制
- 高可靠性：16nm车规级工艺，高性能、低功耗；高效以太网：2个千兆以太网接口，支持TSN双千兆
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸82×45mm；系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

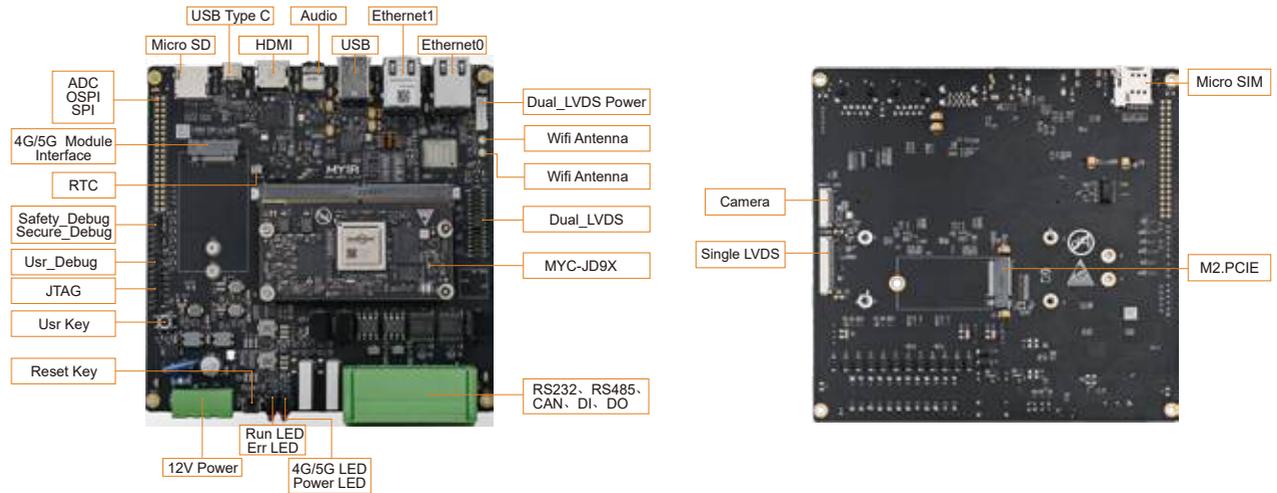
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|---------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|---------|--|------------------------|
| MYC-JD9350-32E4D-160-I | D9-Plus | 5×Cortex-A55@1.6GHz +3×Cortex-R5@800MHz +0.8Tops NPU | 4GB LPDDR4 | 32GB eMMC | E2PROM | MXM 314PIN | -40°C~+85°C | 82×45mm | Linux Android FreeRTOS Ubuntu | MYD-JD9350-32E4D-160-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×千兆以太网，支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC |
| 多媒体接口 | MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI |

● 应用场景



开发板正面标注图

开发板背面标注图

MYC-JD9360核心板

- 基于国产芯驰 D9-Pro高端处理器，内核6×Cortex-A55@1.6GHz+Cortex-R5@800MHz+0.8Tops NPU
- 低功耗：TSMC 车规工业16nm FinFET 先进工业保证相对较低的功耗；内置超大Cache，大带宽DDR4 2400MT/S
- 多屏异显：支持双屏异显2x1080p，支持R5控制第三屏HMI；高清图像VPU：H.264编解码4Kp30，H.265解码4Kp30
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸82×45mm；系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

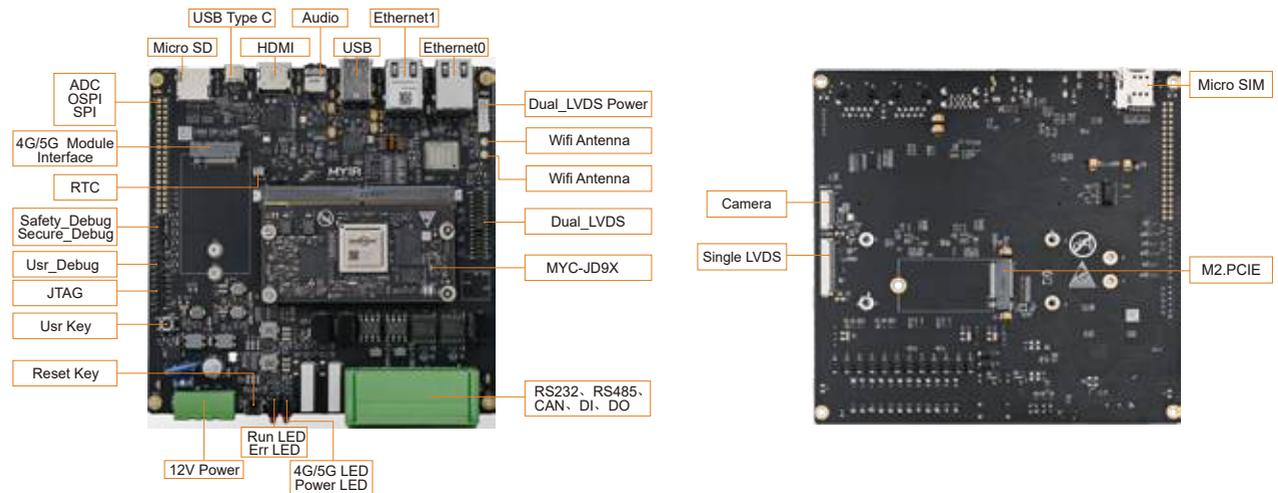
● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|---------|--|------------------------|
| MYC-JD9360-16E2D-160-I | D9-Pro | 6×Cortex-A55@1.6GHz +Cortex-R5@800MHz +0.8Tops NPU | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | E2PROM | MXM 314PIN | -40°C~+85°C | 82×45mm | Linux Android FreeRTOS Ubuntu | MYD-JD9360-16E2D-160-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×千兆以太网，支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC |
| 多媒体接口 | MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI |

● 应用场景

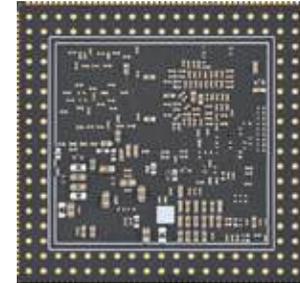


开发板正面标注图

开发板背面标注图

MYC-YD9360核心板

- 基于国产芯驰D9-PRO处理器，集成了6×Cortex-A55@1.6GHz+Cortex-R5@800MHz+0.8Tops NPU
- 高性能的高安全HSM安全的处理器，支持TRNG、AES、RSA、SHA、SM2/3/4/9
- 集成 PCIe3.0, USB3.0, 2x千兆TSN以太网, 4xCAN-FD, 16xUART, SPI 等丰富的外设接口
- LCC+LGA封装, 324PIN; 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸52×50mm; 系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

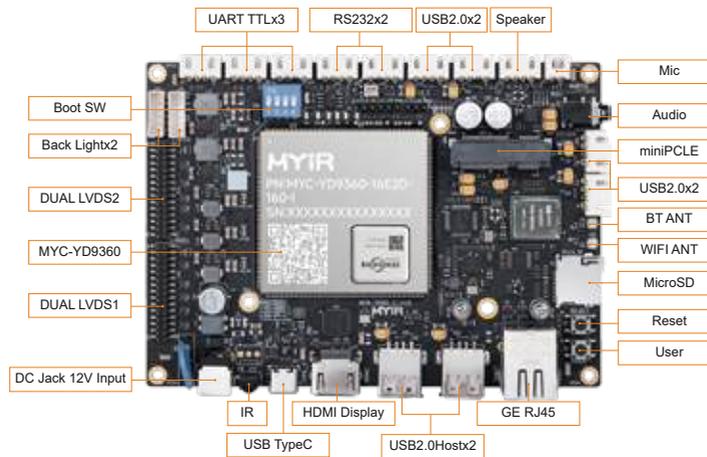
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|------------------------|--------|--|------------|-----------|--------|----------------|-------------|---------|--|------------------------|
| MYC-YD9360-16E2D-160-I | D9-PRO | 6×Cortex-A55@1.6GHz +Cortex-R5@800MHz +0.8Tops NPU | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | E2PROM | LCC+LGA 324PIN | -40°C~+85°C | 52×50mm | Linux Android FreeRTOS Ubuntu | MYD-YD9360-16E2D-160-I |
| MYC-YD9360-16E2D-160-C | | | | | | | 0°C~+70°C | | | MYD-YD9360-16E2D-160-C |

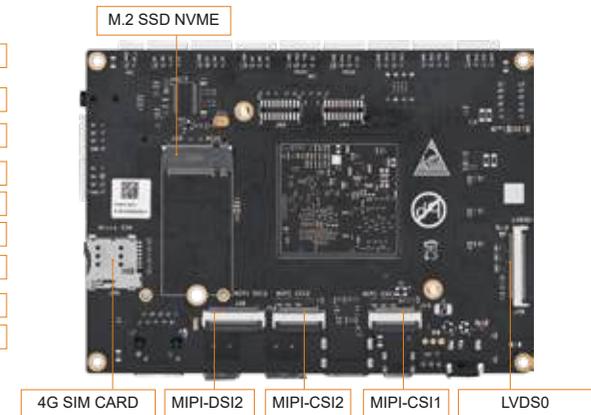
● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×千兆以太网, 支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC |
| 多媒体接口 | 2×MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI |

● 应用场景



开发板正面标注图



开发板背面标注图

Rackchip | MYC-YR3506核心板

- 基于瑞芯微RK3506，3×Cortex-A7@1.5GHz+Cortex-M0@200MHz
- 入门级低成本设计，集成AMP非对称多处理架构，为工业控制、智能终端等提供高效多任务并行能力
- 集成FlexBus与DSMC接口，以高性能低功耗赋能工业、通信及智能设备
- LCC 140PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸37x39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------|-------|--------------------------|
| MYC-YR3506B-8E512D-150-C | RK3506B | 3×Cortex-A7@1.5GHz + Cortex-M0@200MHz | 512MB DDR3L | 8GB eMMC | 32Kbit EEPROM | LCC 140PIN | 0°C~+70°C | 37x39mm | Linux | MYD-YR3506B-8E512D-150-C |
| MYC-YR3506B-256N256D-150-C | | | 256MB DDR3L | 256MB NAND | | | | | | - |
| MYC-YR3506J-256N256D-120-I | RK3506J | 3×Cortex-A7@1.2GHz + Cortex-M0@200MHz | 256MB DDR3L | 256MB NAND | | | -40°C~+85°C | | | - |
| MYC-YR3506J-8E512D-120-I | | | 512MB DDR3L | 8GB eMMC | | | | | | MYD-YR3506J-8E512D-120-I |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|--|
| 通信接口 | 2×RMII、2×USB2.0 OTG、3×SPI、6×UART、2×CAN、3×I2C、12×PWM、DSMC Master、DSMC Slave、Flexbus |
| 多媒体接口 | 2×MIPI-CSI、MIPI-DSI、24bit RGB、SAI、SPDIF、Audio ADC、Audio DSM、ASRC |
| 其他接口 | SARADC |

● 应用场景



工业网关



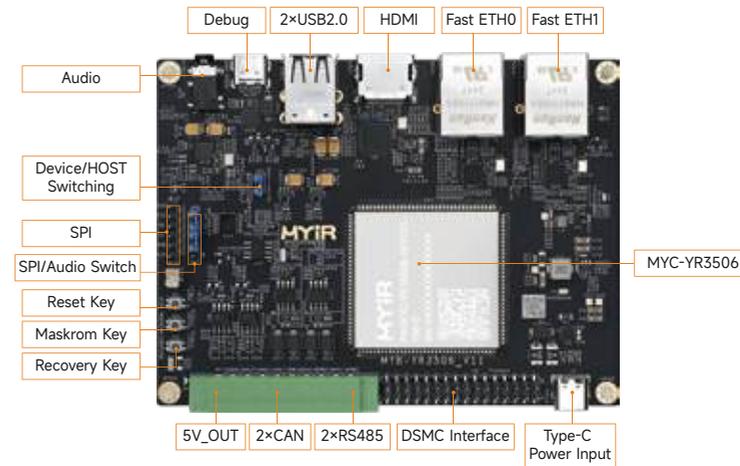
HMI



工业控制



电力智能设备



开发板正面标注图

Rockchip | MYC-YR3562核心板

- 基于瑞芯微RK3562处理器，4×Cortex-A53@2.0GHz+Cortex-M0@200MHz
- GPU G52, VPU 4K@30fps解码, 1080p@60fps 编码, NPU 1Tops
- 接口丰富: RGMII+RMII、PCIE/USB3.0、原生2路CAN接口、10路UART接口等
- LCC+LGA, 222pin封装; 商业级: 0°C~+70°C, 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸43×45mm; 系统Linux、openEuler



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|---------------------------|---------|---|------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|---------|--------------------|----------------------------|
| MYC-YR3562J-16E2D-180-I-G | RK3562J | 4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@200MHz, 1Tops | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | 32Kbit EEPROM | LCC 164pin + LGA 58pin | -40°C~+85°C | 43×45mm | Linux openEuler | MYD-YR3562J-16E2D-180-I-GK |
| MYC-YR3562J-8E1D-180-I-G | | | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | | | | | | - |
| MYC-YR3562-16E2D-200-C | RK3562 | 4×Cortex-A53@2.0GHz+Cortex-M0@200MHz, 1Tops | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | | | 0°C~+70°C | | | MYD-YR3562-16E2D-200-C |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | RGMII+RMII、SDIO、USB3.0/PCIE2.1、USB2.0、10×UART、2×CAN (RK3562J) |
| 多媒体接口 | LVDS、MIPI DSI、Parallel DSI、3×I2S |
| 其他接口 | 6×I2C、16×PWM、3×SPI、26×10bit SARADC |

● 应用场景



工业网关



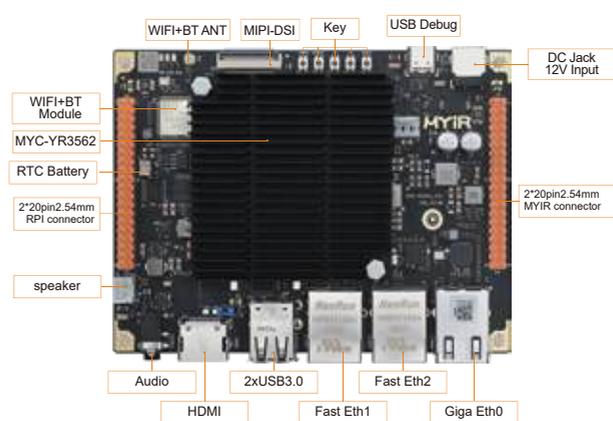
汽车电子



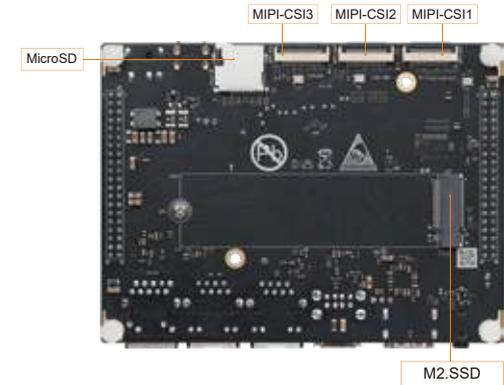
工业制造



智能电力



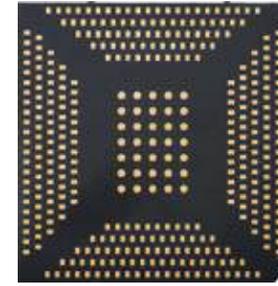
开发板正面标注图



开发板背面标注图

Rackchip | MYC-LR3568核心板

- 基于瑞芯微RK3568处理器，4×Cortex-A55@1.8GHz
- 支持4K高清解码，三屏异显，1 Tops AI加速
- 接口丰富：HDMI、2×GE、PCIE、SATA、10×UART、3×CAN等
- LGA 381PIN；宽温级和工业级可选；尺寸43×45mm；系统Linux、Debian、OpenHarmony



扫一扫了解更多参数

● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|------------|-------------|---------|--------------------------------|----------------------------|
| MYC-LR3568J-32E4D-180-I | RK3568J | 4×Cortex-A55@1.8GHz 1 Tops NPU | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | - | LGA 381PIN | -40°C~+85°C | 43×45mm | Linux Debian OpenHarmony | MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK |
| MYC-LR3568J-16E2D-180-I | | | 2GB LPDDR4X | 16GB eMMC | | | | | | MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK |
| MYC-LR3568J-8E1D-180-I | | | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | | | | | | - |
| MYC-LR3568B2-32E4D-200-E | RK3568B2 | 4×Cortex-A55@2.0GHz 1 Tops NPU | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | - | - | -20°C~+70°C | - | - | MYC-LR3568B2-32E4D-200-E |
| MYC-LR3568B2-16E2D-200-E | | | 2GB LPDDR4X | 16GB eMMC | | | | | | MYD-LR3568B2-16E2D-200-E |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×千兆以太网、2×USB2.0、2×USB3.0、2×PCIe3.0、PCIe2.1、SDIO SATA3.0、10×UART、3×CAN、4×SPI、6×I2C、16×PWM、8×ADC |
| 多媒体接口 | HDMI2.0a、eDP1.3、Dual MIPI-DSI_TX、Single LVDS、Parallel DSI 2×MIPI CSI、Parallel CSI、4×I2S/TDM、8×ADC |

● 应用场景



工业HMI



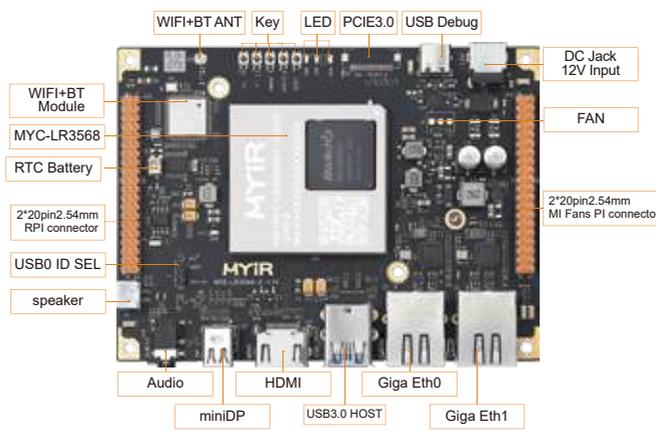
充电桩



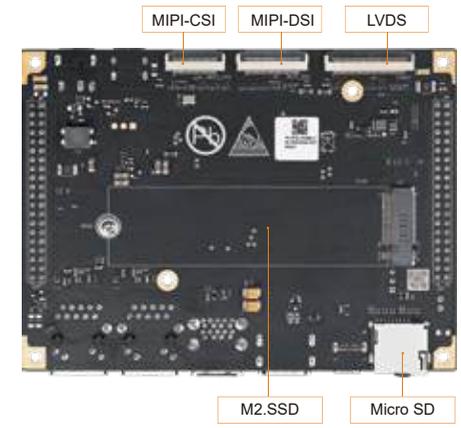
工业制造



电力系列



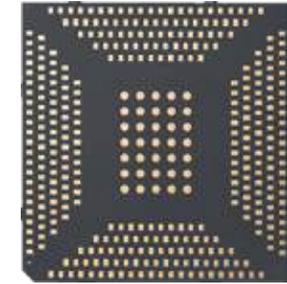
开发板正面标注图



开发板背面标注图

Rockchip | MYC-LR3576核心板

- 基于RK3576处理器，内核4×Cortex-A72@2.2GHz+4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@400MHz
- 6TOPS NPU，赋能边缘计算应用场景
- 支持三屏异显，丰富的多媒体接口HDMI、DVP、MIPI-DSI、MIPI-CSI
- LGA封装，381PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸：43×45mm；系统Linux、Debian、Android



● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| MYC-LR3576-32E4D-220-C | RK3576 | 4×Cortex-A72@2.2GHz+ 4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M0@400MHz 6TOPS NPU | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | 32Kbit EEPROM | LGA 381PIN | 0°C~+70°C | 43×45 mm | Linux Debian Android | MYD-LR3576-32E4D-220-C |
| MYC-LR3576-64E8D-220-C | | | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC | | | | | | MYD-LR3576-64E8D-220-C |
| MYC-LR3576J-32E4D-160-I | RK3576J | 4×Cortex-A72@1.6GHz+ 4×Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M0 6TOPS NPU | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | | | -40°C~+85°C | | | MYD-LR3576J-32E4D-160-I-GK |
| MYC-LR3576J-64E8D-160-I | | | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC | | | | | | MYD-LR3576J-64E8D-160-I-GK |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×千兆以太网、USB/DP combo、PCIe2.1、SDIO、SATA3.0、12×UART、2×CAN FD、5×SPI、10×I2C、10×I3C、DSMC/FlexBus |
| 多媒体接口 | 2×MIPI-CSI、DVP、HDMI、MIPI-DSI、2×SPDIF TX、2×SPDIF RX、5×I2S |
| 其他接口 | 8×SARADC |

● 应用场景



智能医疗



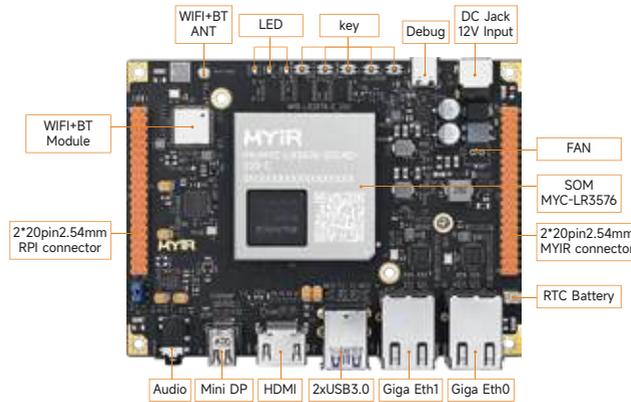
汽车电子



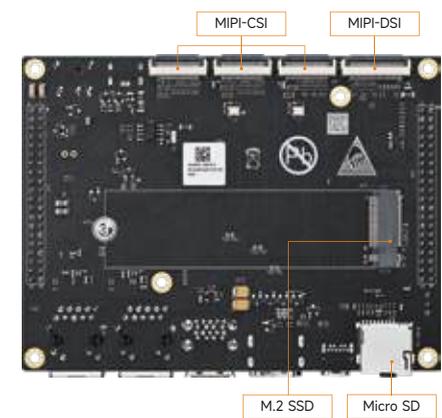
工业制造



智能电力



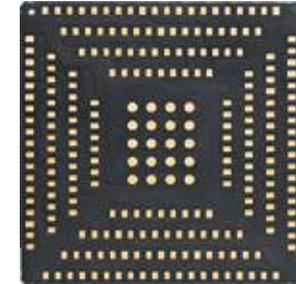
开发板正面标注图



开发板背面标注图

nuvoTon | MYC-LMA35核心板

- 基于新唐MA35D1处理器，2xCortex-A35@800MHz+Cortex-M4@180MHz
- 17路UART和4路CAN FD，提供灵活的数据传输能力
- 集成了2D图形加速器、LCD 控制器、JPEG 和 H.264 解码器
- 具备硬件加速的AES加密引擎和真随机数发生器，支持安全启动和数据加密
- LGA封装，252PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux, Debian
- **产品选型**（其他配置可批量定制）



扫一扫了解更多参数

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------|
| MYC-LMA35-256N256D-80-I | MA35D16A887C | 2xCortex-A35@800MHz +Cortex-M4@180MHz | 芯片内置 256MB DDR3L | 256MB SPI NAND | 32KBit EEPROM | LGA 252PIN | -40°C~+85°C | 37×39mm | Linux Debian | MYD-LMA35-256N256D-80-I |
| MYC-LMA35-8E256D-80-I | | | | 8GB eMMC | | | | | | MYD-LMA35-8E256D-80-I |
| MYC-LMA35-8E512D-80-I | | | 芯片内置 512MB DDR3L | MYD-LMA35-8E512D-80-I | | | | | | |

● 核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×RGMII、2×USB 2.0、4×CAN FD、17×UART、4×SPI、6×I2C、SDIO 3.0 |
| 多媒体接口 | 1×RGB、2×Parallel CSI、2×I2S |
| 其他接口 | 8×EADC、1×JTAG、18×EPWM |

● 应用场景



工业网关



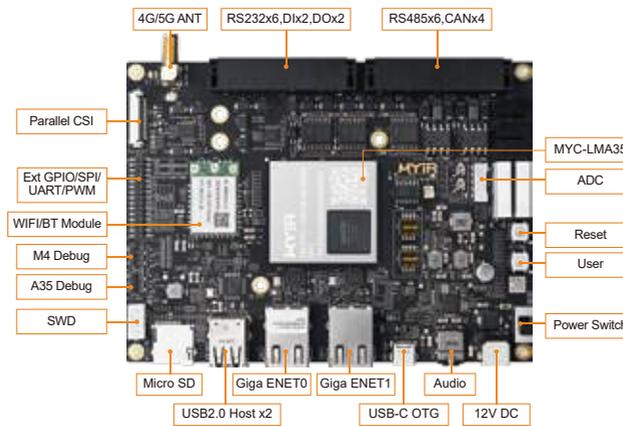
充电桩



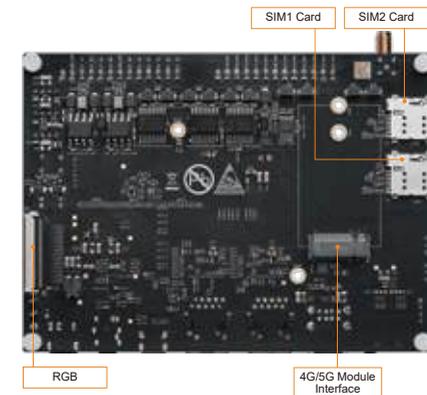
工业制造



电力DTU



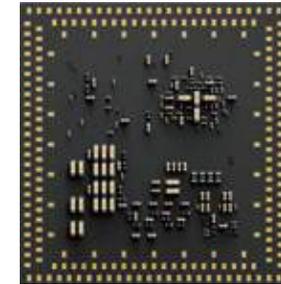
开发板正面标注图



开发板背面标注图

HISILICON | MYC-LHI3093核心板

- 基于国产海思Hi3093处理器，4×Cortex-A55@1.0GHz，实时M3@200MHz，安全M3@400MHz
- 硬件AMP，2*A55应用系统+2*A55硬实时系统+M3安全系统，高性能安全可信模组新标杆
- 接口丰富：2×GE、2×FE、3×USB、2×PCIE、LocalBus、VGA、2×CAN、8×Uart、16×I2C、12×PWM等
- LGA封装，220PIN；宽温级：-20°C~+70°C；尺寸43×45mm；系统openEuler-22.03、libck、FreeRTOS



扫一扫了解更多参数

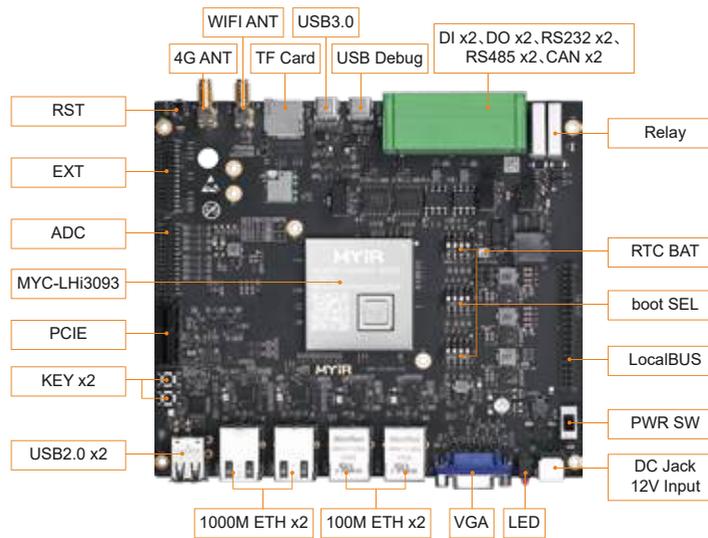
产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------|------|------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|
| MYC-LHI3093-16E2D-100-E | 海思HI3093 | 4×Cortex-A55@1.0GHz +2×M3 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | - | LGA 220PIN | -20°C~+70°C | 43×45mm | openEuler | MYD-LHI3093-16E2D-100-E |

核心板扩展信号

| | |
|-------|---|
| 通信接口 | 2×千兆以太网、2×百兆以太网、3×USB2.0、USB3.0、2×PCIe2.0、8×UART、SDIO2.0、2×SPI、2×CAN、16×I2C、12×PWM、16×ADC |
| 多媒体接口 | VGA |

应用场景



开发板正面标注图



开发板背面标注图

紫光同创 | MYC-J2L100H核心板

- 采用国产紫光同创Logos 系列处理器，可编程逻辑：66600 LUT6s, 133K DFF, 5.5Mb Bram, 240 APM 25X 18
- 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V, LVDS_18, LVDS_25; 285x IOs
- 高速接口：4路6.6Gb/s HSST, 1路PCIE GEN2 X 4
- MXM封装，260PIN；工业级：-40°C~85°C；尺寸69.6×40mm



扫一扫了解更多参数

● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|-----------------------|-------------------|-------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|----|-----------------------|
| MYC-J2L100H-32Q512D-I | PG2L100H-6IFBG484 | - | 512MB DDR3 | 32MB QSPI | 32KB EEPROM | MXM 260PIN | -40°C~85°C | 69.6×40mm | - | MYD-J2L100H-32Q512D-I |

● 核心板外设资源

| 项目 | IO数量 | 描述 |
|---------|--------|-----------------|
| Bank 13 | 35 | 分bank引出178 HRIO |
| Bank14 | 45 | |
| Bank15 | 48 | |
| Bank16 | 50 | |
| MGTP | 4 pair | 6.6Gb/s 串行收发器 |
| JTAG | 4 | JTAG 调试 |

● 应用场景



通信设备



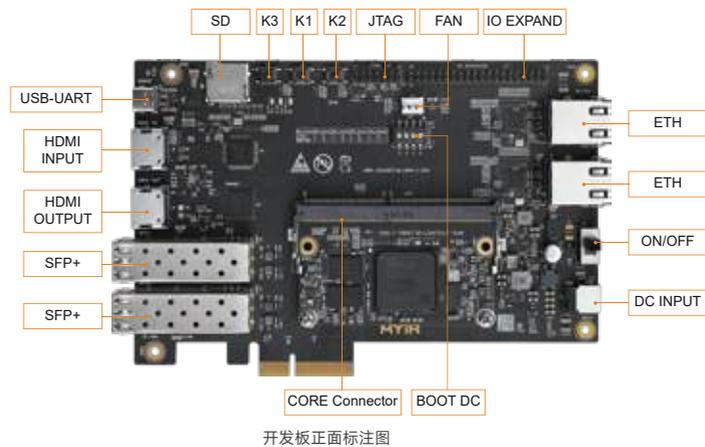
图像处理



工业控制

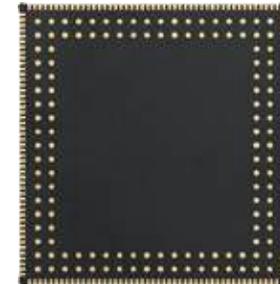


医疗设备



安路科技 | MYC-YM90X核心板

- 采用国产安路SALDRAGON 1系列处理器，内核2×Cortex-A35@1.0GHz，集成0.4 TOPS NPU，支持JPEG压缩解压
- 可编程逻辑：52480 LUT6s，10K DFF，5.4Mb Bram，240 DSP48
- 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V I/O LVDS_18 LVDS_25；200×IOs
- 2×CAN-FD，2×UART，2×SPI，2×I2C，2×三速以太网，2×USB2.0，2×SD / SDIO / eMMC5.1控制器
- LCC+LGA封装，201PIN；工业级：-40°C-85°C；尺寸52×50mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

产品选型 (其他配置可批量定制)

| 核心板型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | MIPI | 封装 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 对应开发板型号 |
|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------|-----------------|------|----------------|------------|---------|-------|----------------------|
| MYC-YM90G-8E1D-100-I | DR1M90GEG484I2 | 2×Cortex-A35 @1.0GHz | 1GB DDR3 | 8GB eMMC | 32MB QSPI Flash | YES | LCC+LGA 201PIN | -40°C-85°C | 52×50mm | Linux | MYD-YM90G-8E1D-100-I |
| MYC-YM90M-8E1D-100-I | DR1M90MEG484I2 | | | | | NO | | | | | MYD-YM90M-8E1D-100-I |

核心板扩展信号

| | |
|------|---|
| PL资源 | 可编程逻辑：52480 LUT6s，10K DFF，5.4Mb Bram，240 DSP48 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V I/O LVDS_18 LVDS_25；200×IOs |
| PS性能 | 2×Cortex-A35@800MHz；集成0.4 TOPS NPU；完整端侧AI部署工具链； 集成JPU：支持JPEG 压缩解压缩；2×CAN-FD，2×UART，2×SPI，2×I2C， 2×三速以太网，2×USB2.0，2×SD / SDIO / eMMC5.1控制器 |

应用场景



机器视觉



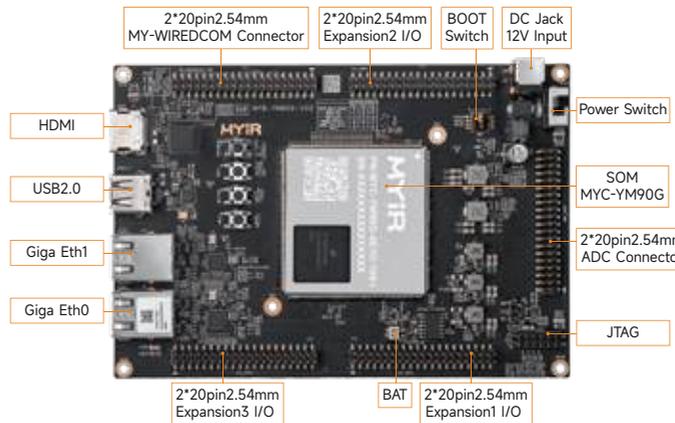
能源电力



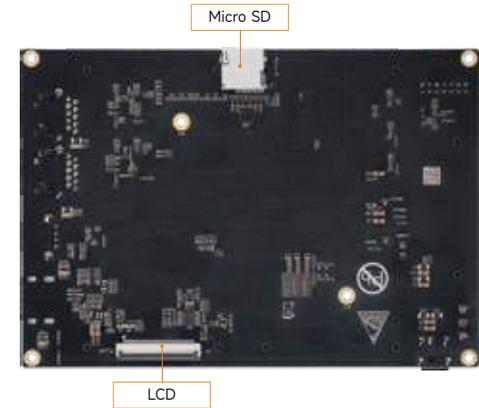
工业控制



汽车电子



开发板正面标注图



开发板背面标注图

应用与方案

嵌入式工业单板机

嵌入式工业单板机是集成了处理器、内存、存储以及各种外设接口的完整计算系统，经过严格的设计和测试，具有较高的稳定性和可靠性，能够长时间稳定运行在恶劣的工业环境中，工程师和开发人员可以直接在上面进行应用开发和部署，广泛应用于工业控制、工业自动化、工业数据采集、医疗器械等领域。

- ▶ 米粉派T527
- ▶ 米粉派RK3568
- ▶ Remi Pi / 瑞米派
- ▶ 开鸿派RK3576
- ▶ MYD-LT527-SX商显板
- ▶ MYD-YD9360商显板
- ▶ MYS-8MMX-V2
- ▶ Z-turn Lite
- ▶ 百度/米尔 FZ3深度学习计算卡
- ▶ Z-turn Board-V2

嵌入式工控一体机

嵌入式工控一体机是专门为工业控制应用而设计的嵌入式计算机，采用一体化设计，将单板机、通信模块、组件和外壳整合在一个设备中，整机拥有抗干扰、耐高低温、防尘防水、长时间稳定运行等特点，广泛应用在工业自动化、仪表测试、数据采集、物联网、智能交通、能源管理、医疗器械、轨道交通等领域。

- ▶ MYD-LT527微型工控机
- ▶ MYD-LR3568微型工控机
- ▶ MYD-LR3576-B边缘计算盒
- ▶ MYD-JD9340工控机
- ▶ MY-EVC700S-V2嵌入式控制单元

ALLWINNER | 米粉派T527



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

米粉派T527是以全志T527处理器为核心的单板电脑（SBC），具备八核A55@1.8GHz，G57 GPU、8K编解码VPU，4GB LPDDR4+32GB eMMC，100%国产化物料核心板。具备HDMI+D-P+MIPI DSI+LVDS四路显示接口，支持4K+1080p双高清异显，支持两路MIPI-CSI 800W摄像接口，3.5mm音频插座，支持双千兆网口、双频WiFi+BT5.2、USB3.0+2*USB2.0扩展、2*CAN2.0、4*IIC、2*SPI、9*UART、3*PWM、2*ADC等。通过兼容树莓派接口40pin插针引出，另外还有米粉派T527自定义40pin插座扩展。



正面



背面

● 应用场景



边缘计算



电力测控终端



机器人控制盒



工控机

● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|------------------------|---------|---|------------|-----------|-------------|----------|----------------------------|
| MYD-LT527M-16E2D-180-E | 全志T527M | 4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -20°C~+70°C | 120×90mm | Android Linux Ubuntu |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 |
|-------|------------------|--|
| 系统 | POWER | 12V DC |
| | KEY | 1路复位按键、1路wakeup、1路用户按键 |
| | SD | 1路Micro SD卡槽 |
| | DEBUG | 2路TTL调试串口，从RPI Interface引脚引出 |
| | 风扇接口 | 1路风扇插座，带PWM调速 |
| 通讯接口 | Ethernet | 2路10/100/1000M以太网RJ45接口 |
| | WIFI/BT | 板载WIFI模块，支持802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2 |
| | USB | 1路USB3.0 +1路USB2.0，采用1x2 Type-A接口 1路USB2.0，40pin插针内 |
| | CAN | 2路CAN接口，通过扩展接口引出 |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路HDMI接口，HDMI A-type插座 |
| | | 1路DP接口，miniDP插座 |
| | | 1路MIPI-DSI，FPC插座 |
| | | 1路single LVDS，FPC插座 |
| | VIDEO INPUT | 2路4 lane MIPI-CSI |
| AUDIO | 1路音频接口，3.5mm耳机插座 | |
| 扩展接口 | RPI Interface | 2.54mm间距的40PIN排针，GPIO/I2C/UART/SPI/CAN |
| | MI Fans PI接口 | 2.54mm间距的40PIN排针，GPIO/I2C/UART/SPI/USB/PWM |

Rockchip | 米粉派RK3568



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYB-LR3568 是与 MYC-LR3568 核心板配套使用的扩展底板，采用 12V/3A 直流供电，搭载了 2 路千兆以太网接口、板载 WIFI+BT 模块、HDMI+miniDP+MIPI DSI+LVDS 四种显示接口、1 路 3.5mm 音频接口、1 路 USB3.0 HOST、1 路 USB3.0 OTG 接口、1 路 Micro SD 接口、1 路兼容树莓派 40pin 扩展接口、1 路米尔自定义 40pin 扩展接口。



正面



背面

● 应用场景



工业HMI



充电桩



工业制造



电力系列

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------|
| MYD-LR3568B2-16E2D-200-E | RK3568B2 | 4×ARM Cortex-A55 @2.0GHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -20°C~+70°C | 120×90mm | Linux Debian OpenHarmony |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 |
|-------|------------------|--|
| 系统 | POWER | 12V DC |
| | KEY | RST、UPLOAD、PWR、V+、V- |
| | SD | 1路Micro SD卡槽 |
| | SSD | M.2 NVME SSD盘插座，尺寸2280，PCIE信号 |
| | DEBUG | USB TYPE-C，内置USB转TTL DEBUG |
| | 风扇接口 | 1路风扇插座，带PWM调速 |
| 通讯接口 | Ethernet | 2路10/100/1000M以太网RJ45接口 |
| | WIFI/BT | 板载WIFI模块，支持802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2 |
| | USB | 2路USB3.0，采用1x2 Type-A接口 1路USB2.0，40pin插针内 |
| | CAN | 2路CAN接口，通过扩展接口引出 |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路HDMI接口，HDMI A-type插座 |
| | | 1路DP接口，miniDP插座 |
| | | 1路MIPI-DSI，FPC插座 |
| | | 1路single LVDS，FPC插座 |
| | VIDEO INPUT | 1路4 lane MIPI-CSI |
| AUDIO | 1路音频接口，3.5mm耳麦插座 | |
| 扩展接口 | RPI Interface | 2.54mm间距的40PIN排针，GPIO/I2C/UART/SPI/CAN |
| | MiFAN Interface | 2.54mm间距的40PIN排针，GPIO/I2C/UART/SPI/USB/PWM |

Rockchip | 开鸿派RK3576



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

开鸿派是一款以瑞芯微RK3576处理器，4核Cortex-A72和4核Cortex-A53内核为核心的嵌入式板卡，配备6TOPS NPU，集成了千兆以太网、USB3.0、Micro SD 卡槽、Micro HDMI 接口、Mini DP、树莓派双排针接口、LED 指示灯、MIPI DSI 接口、MIPI -CSI 接口、M.2 WiFi 接口、TTL 调试串口等接口。



正面



背面

● 应用场景



触控一体机



边缘计算



工业制造



多屏商显

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|---------------------------|--------|--|------------|-----|-------------|----------|------|
| MYS-R3576-TF4D-220-C-KHPI | RK3576 | 4×Cortex-A72@2.2GHz+ 4×Cortex-A53@1.8GHz +Cortex-M0, 6TOPS NPU | 4GB LPDDR4 | / | -20°C~+70°C | 56×85 mm | 开鸿os |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 |
|-------------|-------------------|--|
| 系统 | POWER | 5V4A |
| | KEY | 复位按键、RECOVERY、MASKROM |
| | SD | 1路Micro SD卡槽 |
| | DEBUG | 1 路 Debug 接口，使用串口隔离通过 3PIN 排针引出 |
| | 风扇接口 | 1路风扇插座 |
| 通讯接口 | Ethernet | 1路10/100/1000M以太网RJ45接口 |
| | USB | 4路USB3.0 |
| | WIFI/BT | 1 路 WIFI5 /Ble 接口（带音频）， ipex 插座 1 路 M.2 的 WIFI6/Ble 接口， KEY-E |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路HDMI接口， Mirco HDMI插座 |
| | | 1路DP接口， Mini DP插座 |
| | | 1路MIPI-DSI, FPC插座 |
| VIDEO INPUT | 1路4 lane MIPI-CSI | |
| 扩展接口 | RPI Interface | 2.54mm间距的40PIN排针， I2C/SPI/SAI/CAN/UART/PWM/GPIO |

RENESAS | Remi Pi / 瑞米派



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

Remi Pi是一款以瑞萨RZ/G2L处理器，Cortex-A55内核为核心的嵌入式板卡，主频为1.2GHz。配备了1GB高速DDR4和8GB eMMC，集成了双路千兆以太网、双频2.4GHz/5GHz WIFI+BT4.2 模块、USB 2.0 HOST、USB 2.0 OTG、HDMI显示接口、LVDS显示接口、MIPI CSI摄像头接口、音频输入输出接口以及兼容树莓派的40PIN接口。



Remi Pi正面



Remi Pi背面

● 应用场景



工业HMI



医疗器械



工业自动化



商业显示

● 产品参数

| 功能 | 参数 |
|---------------|---|
| 处理器 | 瑞萨RZ/G2L(2*Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz) |
| 内存 | 1GB DDR4 |
| 存储器 | 8GB eMMC |
| 电源 | PMIC, RAA215300 |
| 供电 | USB Type-C 供电接口 |
| WIFI/BT | 2.4GHz/5GHz WIFI+BT4.2 模块 |
| Ethernet | 2路千兆以太网接口 |
| USB | 1路USB 2.0 OTG Type-C接口 |
| | 2路USB 2.0 HOST Type-A接口 |
| Multimedia | 1路HDMI显示接口 |
| | 1路LVDS显示接口 |
| | 1路MIPI CSI摄像头接口 |
| | 1路音频输入输出接口 |
| Debug | 2路UART debug (Cortex-A55, Cortex-M33) |
| Buttons | ON/OFF, RESET, USER |
| Status LED | Power,system status |
| RPI Interface | 1路兼容树莓派的40PIN Header, GPIO/I2C/UART/SPI/CAN |
| RTC | Used for timing when power off |

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|----------------------------|-----------------|---|----------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| MYD-YG2L23-8E1D-120-C-REMI | R9A07G044L23GBG | 2xCortex-A55@1.2GHz+ Cortex-M33@200MHz | 1GB DDR4 | 8GB eMMC | 0°C~+70°C | 120×70mm | Linux Ubuntu Debian |



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-YD9360商显板基于芯驰D9360处理器为核心的高清多屏商显主板，具备六核A55@1.6GHz，100GFLOPS GPU、4K编解码VPU、0.8Tops AI NPU的核心，硬件存储ECC、ASIL B功能安全，2GB LPDDR4+16GB eMMC，100%国产化物料核心板。具备HDMI+2*LVDS+MIPI DSI四路显示接口，支持三屏异显，支持两路MIPI-CSI摄像接口，3.5mm音频插座，支持千兆网口、WIFI-I+BT、7*USB扩展、2*IIC、5*UART等。



MYD-YD9360商显板正面



MYD-YD9360商显板背面

● 应用场景



机械工程智能盒



智能医疗器械



工业机器人



智能座舱

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|-------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|
| MYD- YD9360-16E2D-160-C | 芯驰D9-Pro (D9360) | 6×Cortex-A55@1.6GHz + Cortex-R5@800MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -20°C~+70°C | 140×100mm | Android Linux Ubuntu |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 | |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 系统 | POWER | 12V 2A, DC-Jack座子 | |
| | KEY | 1路复位按键、1路用户按键 | |
| | BOOT SET | 1路拨码开关 | |
| | SD | 1路Micro SD卡槽，可以接入128G TF卡； | |
| | SSD固态硬盘槽位 | M.2 B插座，4 lane PCIE信号，可接入NVME固态硬盘； | |
| | LED | 1路5G/4G状态指示灯，1路系统运行指示灯 2路电源指示，1路用户自定义灯(默认报错指示灯) | |
| DEBUG | | 1路Safety域调试串口，1路AP域调试串口 | |
| | | 1路Secure调试串口 | |
| 通讯接口 | WIFI/BT | 板载WIFI/BT模块 | |
| | 5G/4G | 1路MINI PCIE型插座5G/4G模块接口，1路SIM卡座 | |
| | Ethernet | 1路10/100/1000M以太网接口，RJ45接口，支持TSN | |
| | USB | | 2路 USB 2.0 HOST 接口，采用Type-A接口 |
| | | | 4路USB 2.0 HOST 接口，采用4PIN座子引出 1路USB 2.0 软件烧写接口，采用Type-C接口 |
| | UART | 3路UART接口，通过4PIN座子引出；2路RS232接口，通过4PIN座子引出 | |
| | IR | 1路红外输入 | |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 2路双通道LVDS 显示接口 | |
| | | 1路HDMI接口+1路LVDS，由MIPI-DSI转换得来 1路MIPI DSI接口，通过30PIN的FPC座子引出 | |
| | CAMERA | 2路MIPI CSI摄像头接口 | |
| AUDIO | 1路双声道音频输出接口，2路单通道音频输入接口，1路双声道的功放接口 | | |
| 扩展接口 | Expansion IO | 2路扩展接口，用作预留 | |

ALLWINER | MYD-LT527-SX商显板



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYB-LT527-SX 是与 MYC-LT527 核心板配套使用的扩展底板，采用12V 直流供电，搭载了2路千兆以太网接口、1路 miniPCIE 型插座的 5G/4G 模块接口、板载WIFI/蓝牙模块、1路HDMI 显示、1路双 LVDS 显示、1路 eDP 显示、1路 MIPI-DSI 显示、2路 MIPI-CSI 摄像、1路3.5mm耳麦接口、1路内置 mic、2路扬声器、2路 USB Type A、4路 4PIN 座子USB HOST 接口、1路MicroS-D、2路 RS232 接口、1路 RS485、2路 TTL UART 接口、2路 CAN 及其他扩展接口。



正面



背面

● 应用场景



车载显控



商业显示



高性能机器人



工业HMI

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|---------------------------|---------|---|------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|
| MYD-LT527M-16E2D-180-E-SX | 全志T527M | 4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -20°C~+70°C | 140×100mm | Android Linux Ubuntu |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 | |
|-------|--------------|---|--------------------------------|
| 系统 | POWER | 12V 2A, 5.5-2.1带锁DC座 | |
| | KEY | 1路复位按键、1路用户按键 | |
| | TF Card | 1路TF卡槽, 可以接入128G TF卡; | |
| | LED | 1路电源指示, 1路用户自定义灯(默认报错指示灯) | |
| | DEBUG | 1路TTL调试串口 | |
| 通讯接口 | WIFI/BT | 板载WIFI/BT模块 | |
| | 5G/4G | 1路MINI PCIE型插座5G/4G模块接口, 1路SIM卡座 | |
| | Ethernet | 1路10/100/1000M以太网接口, RJ45接口, 支持TSN | |
| | USB | | 1路 USB 2.0 OTG接口, 采用Type-A接口 |
| | | | 1路 USB 3.0 HOST接口, 采用Type-A接口 |
| | | | 4路 USB 2.0 HOST 接口, 采用4PIN座子引出 |
| | UART | | 1路RS485接口, 通过4PIN座子引出; |
| | | 2路RS232接口, 通过4PIN座子引出; | |
| | | 2路TTL UART接口, 通过4PIN座子引出; | |
| IR | | 1路红外输入 | |
| 多媒体接口 | DISPLAY | HDMI、LVDS、eDP、MIPI DSI接口各1路, 2路背光、1路I2C触摸接口 | |
| | CAMERA | 2路MIPI CSI摄像头接口 | |
| | AUDIO | 1路3.5mm耳麦接口, 1路mic输入接口, 1路双声道的扬声器接口 | |
| 扩展接口 | Expansion IO | 2路扩展接口, 用作预留 | |

NXP | MYS-8MMX-V2



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYS-8MMX-V2单板，基于i.MX8MMini处理器，将良好的处理能力与先进的音频、视频和图形功能集于一身，提供低功耗、高性能的解决方案，采用先进的14LPC FinFET工艺技术构建，提供更快速度和更高的电源效率。凭借商业和工业级认证以及恩智浦产品长期供货计划的支持，i.MX 8M Mini家族可用于任何通用工业和物联网应用。



MYS-8MMX-V2带外壳



MYS-8MMX-V2单板正面

● 应用场景



智慧消防



医疗器械



能源电力



工业控制

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 | 有无外壳 |
|---------------------------|-----------------|--|----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-C | MIMX8MM6DVTLZAA | 4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M4@400MHz | 2GB DDR4 | 8GB eMMC | 0°C~+70°C | 95×69mm | Linux Ubuntu | 无外壳 |
| MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-C-B | | | | | | 135×74.5×35.8mm | | 有外壳 |
| MYS-8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MIMX8MM6CVTKZAA | 4×Cortex-A53@1.6GHz+ Cortex-M4@400MHz | | | -40°C~+85°C | 95×69mm | | 无外壳 |
| MYS-8MMQ6-V2-8E2D-160-I-B | | | | | | 135×74.5×35.8mm | | 有外壳 |

● 产品参数

| 功能 | 参数 |
|----------|---------------------------------|
| CPU型号 | MIMX8MM6DVTLZAA 高达1.8GHz |
| DDR | 2GB DDR4 |
| eMMC | 8GB eMMC |
| 电源输入 | x1 凤凰端子 (2 PIN) |
| USB | x1 Type-C USB |
| | X2 USB 2.0 HOST Type A |
| 显示触摸 | x1 单路LVDS, 40pin FPC接口, 支持触摸电容屏 |
| | x1 HDMI输出 |
| 网络 | X1 千兆以太网RJ45 |
| SMA | x1 WIFI/BT天线SMA |
| RTC电池座 | x1 1.25MM间距 2PIN座子 |
| M.2座子 | x1 SSD卡2242 |
| 摄像头 | x1 MIPI接口数字摄像头信号, 24pin FPC |
| 扩展排针 | x1 2x25_2.0mm 间距双排针 |
| Micro SD | x1 Micro SD 插槽 用于Micro SD 卡启动 |
| 按键 | x1 Reset 复位按键 |
| | x1 ONOFF 开关机按键 |
| | x1 用户自定义按键 |
| 调试串口 | x1 3 Pin 2.54mm间距 |



扫一扫了解更多参数

AMD | 百度/米尔 FZ3深度学习计算卡

● 产品介绍

采用了AMD最新的基于16nm工艺的Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC平台，集成了四核Cortex-A53处理器，双核 Cortex-R5 实时处理单元以及Mali-400 MP2 图形处理单元及 16nm Fin-FET+ 可编程逻辑相结合的异构处理系统，具有高性能，低功耗，高扩展等特性，能在工业设计中满足各种需要。

● 产品参数

| 功能 | 参数 |
|------------|------------------------------------|
| CPU | XCZU3EG |
| DDR | 2GB DDR4 64bit (512MB*4); 4GB可选 |
| eMMC | 8GB eMMC |
| QSPI FLASH | 32MB QSPI |
| EEPROM | 32KB I2C eeprom |
| PHY | Gigabit PHY * 1 |
| | USB 2.0 PHY * 1 |
| Mini DP | 4K/30fps (2lane) |
| Ethernet | 1000Mbps |
| USB3.0 | 5Gbps |
| USB2.0 | 2 in USB3.0 CON, 2 in Expansion IO |
| PCIe | PCIe 2.1 x 1 lane |
| MIPI | FPC_25PIN 4lane |
| BT1120 | FPC_32PIN 16bit |



正面



背面

● 应用场景



安防监控



医疗器械



工业质检



人工智能

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 其他存储 | 软件 |
|---------------------------------|-------------------|---|----------|----------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| MYS-ZU3EG-8E2D-EDGE (裸卡) | XCZU3EG-1SFVC784I | ARM:4×A53@1200MHz+ 2×R5@533MHz+ UltraScale+ FPGA 154K | 2GB DDR4 | 8GB eMMC | -40°C~+85°C | 32MB QSPI FLASH 32KB EEPROM | Linux 5.4.0 百度Paddle框架 |
| MYS-ZU3EG-8E2D-EDGE-K2 (裸卡+配件包) | | | 4GB DDR4 | | | | |
| MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE (裸卡) | | | | | | | |
| MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE-K2 (裸卡+配件包) | | | | | | | |

AMD | Z-turn Lite



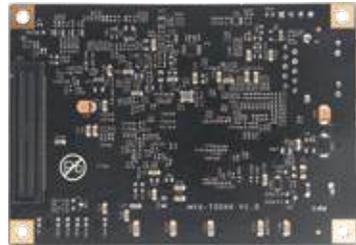
扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

Z-turn Lite是米尔推出的一款Z-turn精简版开发板。主板基于ZYNQ-7000S系列中的XC7Z007S单核ARM+FPGA的SOC为核心（可选XC7Z010），搭载开发必备的10/100/1000M网口、USB OTG、TF卡、JTAG接口，其余接口通过扩展引出，方便用户以最低成本实现芯片评估和产品开发。



正面



背面

● 应用场景



汽车行业



医疗器械



工业领域



视觉监控

● 产品选型（其他配置可批量定制）

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|---------------------|-----------------|---|------------|----------|-----------------|-----------|---------|-------|
| MYS-7Z010-L-C（配套件） | XC7Z010-1CLG400 | 2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA（28K） | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 16MB QSPI Flash | 0°C~+70°C | 91×63mm | Linux |
| MYS-7Z010-L-C-S（裸板） | XC7Z010-1CLG400 | | | | | | | |

● 产品参数

| 功能 | 参数 |
|-------|---------------------------------|
| CPU | Xilinx XC7Z010, ARM Cortex-A9内核 |
| | 最高支持866MHz主频 |
| DDR | 512MB DDR3 SDRAM |
| Flash | 4GB eMMC Flash, 16MB QSPI Flash |
| 网口 | 1路10/100/1000Mbps以太网接口 |
| USB | 1路mini USB OTG接口 |
| 调试接口 | 1个14PIN双排JTAG调试接口, 1路UART调试串口 |
| TF卡 | 1路TF卡接口 |
| 按键 | 1个复位按键, 1个用户按键 |
| 扩展接口 | 1个120PIN双排接口 |
| PCB规格 | 10层板设计, 沉金工艺, 独立的接地信号层, 无铅 |
| 机械尺寸 | 91mm x 63mm |
| 软件支持 | Linux 4.14.0操作系统 |

AMD | Z-turn Board V2



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

Z-turn Board是一款基于Xilinx Zynq-7000系列SoC芯片的FPGA+ARM的嵌入式单板，该产品降低了SoC系统的开发门槛，主要满足于工业控制、医疗、汽车、监控等领域。



正面



背面

● 应用场景



汽车行业



医疗器械



工业领域



视觉监控

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 其他板载 | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|--------------------------------|-----------------|--|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-------|
| MYS-7Z010-V2-0E1D-667-C (配套件) | XC7Z010-1CLG400 | 2xCortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K) | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 16MB QSPI Flash | 0°C~+70°C | 63×102mm | Linux |
| MYS-7Z010-V2-0E1D-667-C-S (裸板) | | | | | | | | |
| MYS-7Z020-V2-0E1D-766-C (配套件) | XC7Z020-2CLG400 | 2xCortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K) | | | | | | |
| MYS-7Z020-V2-0E1D-766-C-S (裸板) | | | | | | | | |

● 产品参数

| 功能 | 参数 |
|--------|--------------------------------------|
| CPU | Xilinx XC7Z010/XC7Z020, 最高支持866MHz主频 |
| DDR | 1GB DDR3 SDRAM |
| Flash | 16MB QSPI Flash |
| 传感器 | 三轴加速度计传感器, 温度传感器 |
| USB | 1路mini USB OTG接口, 1路USB调试串口 |
| HDMI | 1路HDMI高清输出接口 |
| TF卡 | 1路TF卡接口 |
| CAN | 1路CAN接口 |
| 网口 | 1路10/100/1000Mbps以太网接口 |
| 用户扩展接口 | 2个80PIN (共160PIN) 双排接口, 间距1.27mm |
| | PLIO: 90/106(XC7Z010/XC7Z020) |
| PCB规格 | 8层板设计, 沉金工艺, 独立的接地信号层, 无铅 |
| 机械尺寸 | 63mm x 102mm |
| 软件支持 | Linux 4.14.0操作系统 |

ALLWINNER | MYD-LT527微型工控机



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-LT527微型工控机是以全志T527处理器为核心的miniPC产品，具备八核A55@1.8GHz，G57 GPU、8K编解码VPU、2Tops AI NPU的核心，4GB LPDDR4+32GB eMMC，100%国产化物料核心板。具备HDMI+miniDP显示接口，支持4K+1080p双高清异显，支持两路MIPI-CSI 800W摄像接口，3.5mm音频插座，支持双千兆网口、双频WIFI+BT5.2、4G/5G无线通讯、USB3.0+4*USB2.0扩展等。通过兼容树莓派接口40pin插针引出，另外还有米粉派自定义40pin插座扩展。



MYD-LT527微型工控机正面



MYD-LT527微型工控机背面

● 应用场景



边缘计算机



电力智能设备



大算力控制器



综合网关

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|------------------------------|----------|--|------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|
| MYD-LT527MN-32E4D-180-I-GK-B | 全志T527MN | 4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz, 2Tops NPU | 4GB LPDDR4 | 32GB eMMC | -40°C~+85°C | 160×93.5×44mm | Android Linux Ubuntu |
| MYD-LT527M-16E2D-180-I-GK-B | 全志T527M | 4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | | | |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 | |
|-------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 系统 | POWER | 12VDC 5.08凤凰端子 | |
| | KEY | 1路RST复位按键、1路USER用户按键 | |
| | SD | 1路Micro SD卡槽 | |
| 通讯接口 | Ethernet | 2路10/100/1000M以太网RJ45接口 | |
| | WIFI/BT | 双频WIFI模块，支持802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2 | |
| | 4G/5G | 板载miniPCIE插槽，SIM卡插槽，可支持4G/5G模块 | |
| | USB | | 1路USB2.0，在1x2 Type-A接口上部 |
| | | | 1路USB3.0，在1x2 Type-A接口下部 |
| | | | 3路USB2.0，Type-A接口 |
| UART | 2路RS485接口，1路RS232接口 | | |
| CAN | 2路CAN接口 | | |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路HDMI接口，HDMI A-type插座 | |
| | | 1路DP接口，miniDP插座 | |
| | AUDIO | 1路音频接口，3.5mm耳麦插座 | |

Rackchip | MYD-LR3568微型工控机



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-LR3568微型工控机是以瑞芯微RK3568为核心的miniPC产品，具备四核A55@1.8GHz，G52 GPU、4K编解码VPU、1Tops AI NPU的核心，4GB LPDDR4+32GB eMMC，100%国产化物料核心板。



MYD-LR3568微型工控机正面



MYD-LR3568微型工控机背面

● 应用场景



工控机



多屏高清播放器



电力测控终端



数据采集

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|
| MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK-B | 瑞芯微RK3568J | 4×Cortex-A55@1.8GHz 1Tops NPU | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -40°C~+85°C | 160×94×44mm | Linux Ubuntu Android |
| MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK-B | | | 4GB LPDDR4 | 32GB eMMC | | | |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 |
|-------|----------|-------------------------------------|
| 系统 | POWER | 12VDC 5.08凤凰端子 |
| | Debug | 1路USB Type-C, 内置USB转UART DEBUG |
| | KEY | RST、UPLOAD、PWR、+、- |
| | SSD | M.2 2280 NVME SSD固态硬盘槽位 |
| | SD | 1路Micro SD卡槽 |
| 通讯接口 | Ethernet | 2路10/100/1000M以太网RJ45接口 |
| | WIFI/BT | 双频WIFI模块, 支持802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2 |
| | 4G/5G | 板载miniPCIE插槽, SIM卡插槽, 可支持4G/5G模块 |
| | USB | 2路USB3.0, 在1x2 Type-A接口 |
| | | 3路USB2.0, Type-A接口 |
| | UART | 2路RS485接口, 1路RS232接口 |
| CAN | 2路CAN接口 | |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路HDMI接口, HDMI A-type插座 |
| | | 1路DP接口, miniDP插座 |
| | AUDIO | 1路音频接口, 3.5mm耳麦插座 |

Rockchip | MYD-LR3576-B边缘计算盒



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-LR3576-B 边缘计算盒是在 MYD-LR3576 开发板基础上衍生的产品，为客户提供一种适应性广泛、算法丰富的边缘计算盒子产品。提供完整的硬件，资料丰富，支持灵活安装应用软件，方便客户二次开发。



MYD-LR3576-B边缘计算盒正面



MYD-LR3576-B边缘计算盒背面

● 应用场景



边缘计算机



电力智能设备



工业控制



综合网关

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|--------------------------|--------|---|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| MYD-LR3576-64E8D-220-C-B | RK3576 | 4×Cortex-A72@2.2GHz+ 4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M0@400MHz, 6TOPS NPU | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC | 0°C~+70°C | 165×93×34.5mm | Debian Linux Android |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 |
|-------|-------------------|---|
| 系统 | 处理器 | RK3576处理器, 6TOPS NPU |
| | 内存 | 8GB LPDDR4X |
| | 存储 | EMMC, 64GB |
| | 扩展存储 | 1路M.2 2280 NVME SSD固态硬盘槽位 1路Micro SD卡槽, 支持16GB-128GB |
| | Debug | 1路 Debug 接口, 使用串口转成 USB 信号, Type C 引出 |
| 通讯接口 | 操作系统 | Debian、Linux、Android |
| | 电源输入 | 5.5/2.1 DC 插座, DC 12V@3A 输入 |
| | 以太网 | 2路10/100/1000M以太网RJ45接口 |
| | WIFI/BT | 板载WIFI/BT模块, 支持802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2 |
| 多媒体接口 | USB | 2路 USB Type-A 插座, USB 3.0 OTG 接口 |
| | 显示 | 1路HDMI 接口, 支持分辨率4K@120Hz |
| | | 1路DP接口, 最高支持分辨率4K@120Hz |
| 音频 | 1路音频接口, 3.5mm耳麦插座 | |
| | 电源输入 | 12VDC±20% 2A, 5.08凤凰端子 |
| | 工作温度 | 0°C ~ +70°C |



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-JD9340工控机是以芯驰D9340处理器为核心的边缘计算网关产品，具备四核A55@1.6GHz，32GFLOPS GPU、1080p编解码VPU、硬件存储ECC、ASIL B功能安全，2GB LPD-DR4+16GB eMMC，100%国产化物料核心板。具备HDMI+1*双LVDS+1*单LVDS三路显示接口，支持双屏异显，支持1路MIPI-CSI摄像接口，3.5mm音频插座，支持双千兆网口、WIFI+BT、3*USB扩展、2*RS232、2*RS485、2*CANFD、2*DI、2*DO等。



MYD-JD9340工控机正面



MYD-JD9340工控机背面

● 应用场景



边缘计算机



电力智能设备



大算力控制器



综合网关

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作温度 | 尺寸 | 软件 |
|----------------------------|--------------|--|------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------|
| MYD-JD9340-16E2D-160-I-B4G | 芯驰D9 (D9340) | 4×Cortex-A55@1.6GHz +2×Cortex-R5@800MHz | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -40°C~+85°C | 160×154×40mm | Android Linux Ubuntu |

● 产品参数

| | 功能 | 参数 | |
|-------|--------------------------|---|--|
| 系统 | POWER | 12V/2A, 3PIN凤凰接线端子 | |
| | KEY | 1路复位按键、1路用户按键 | |
| | BOOT SET | 1路4bit拨码开关 | |
| | SD | 1路Micro SD卡槽 | |
| | LED | 1路5G/4G状态指示灯, 1路系统运行指示灯 1路电源指示, 1路用户自定义灯 | |
| DEBUG | 1路API调试串口, | | |
| | 1路R5调试串口, 1路JTAG调试接口 | | |
| 通讯接口 | WIFI/BT | 板载WIFI/BT模块 | |
| | 5G/4G | 1路M.2 B型插座5G/4G模块接口 / 1路SIM卡座 | |
| | Ethernet | 2路10/100/1000M以太网接口, RJ45接口, 支持TSN | |
| | USB | 2路 USB 3.0 HOST 接口, 采用Type-A接口 | |
| | | 1路USB 2.0 DRD接口, 采用Type-C接口 | |
| | UART | 2路带隔离的RS485接口, 通过凤凰端子引出 | |
| | | 2路RS232接口, 通过凤凰端子引出 | |
| | CAN | 2路带隔离的CAN接口, 通过凤凰端子引出 | |
| DI/DO | 各2路带隔离的DI、DO接口, 通过凤凰端子引出 | | |
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路双通道LVDS显示接口 | |
| | | 1路HDMI接口, 通过MIPI-DSI转 | |
| | | 1路单通道LVDS显示接口, 通过MIPI-DSI转 | |
| | CAMERA | 1路MIPI CSI摄像头接口 | |
| AUDIO | 1路音频输入输出接口 | | |
| 扩展接口 | Expansion IO | 1路扩展接口, 通过排针引出 | |



扫一扫了解更多参数

MY-EVC700S-V2嵌入式控制单元

● 产品介绍

米尔电子充电桩计费控制单元，通过软硬件接口连接相应输入/输出组件，完成人机显示、计量计费、支付、数据加解密、控制充电设备启停、与运营平台通信等功能。



正面



背面

● 应用场景



充电桩计费控制



医疗器械



工业领域



电力网关



数据采集

● 产品参数

| 功能 | 指标要求 |
|---------|---|
| CPU主频 | T113-i@1.1GHz |
| 内存 | 512MB, DDR3 |
| eMMC | 4GB |
| 外扩存储 | 标准SD卡, 支持最高32G; SD卡安装方式: 标准SD卡, 外插式安装 |
| 移动通信 | 配置同时支持中国移动、中国联通、中国电信的4G全网通通信模块 1个标准SIM卡插槽, 无线拨号程序具备断线自动重连功能 |
| 蓝牙、WIFI | 蓝牙、WIFI集成的模块, 蓝牙5.0 |
| HDMI | 带触摸的LVDS转HDMI模块 |
| 触摸彩屏 | LVDS接口(20线), 4线电阻触摸屏接口, 4线背光源接口 |
| 掉电检测 | 1路GPIO, 备输入工作电源掉电不间断持续供电10s以上功能 |
| UART | 3路RS232: RS232-1: Console口; RS232-2: 读卡器通信; RS232-3: 备用; 2路RS485: RS485-1: 电表通信; RS485-2: 备用; |
| USB | 2路USB: USB-01: USB HUB 引出USB接口, 于插入U盘; USB-02: 用于4G模块 |
| CAN BUS | 2路CAN: CAN-01: CAN2.0 B, 125/250kbps, 与充电控制器通信; CAN-02: 备用 |
| 网络 | 1路10/100M: RJ45-01: 用于连接上级系统 |
| 声音 | (1) 蜂鸣器; (2) 内置功放, ≥0.5W, 标准3.5音频插口, 立体声 |
| 时钟 | RTC时钟, 具有掉电保持至少1年功能 |

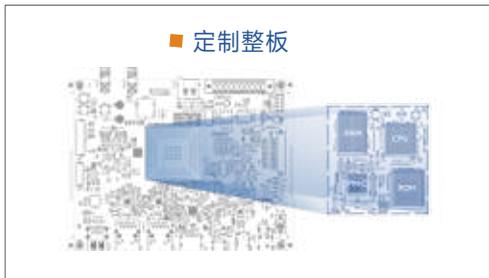
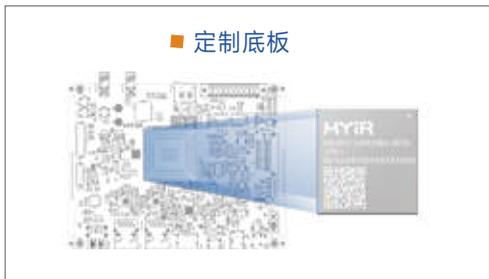
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

| 产品型号 | 主芯片 | 内核+主频 | RAM | ROM | 工作和存储环境 | 尺寸 | 软件 |
|---------------|--------|------------------|------------|----------|---|----------------|-------|
| MY-EVC700S-V2 | T113-i | 2×Cortex-A7@1.1G | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 湿度: 5% ~ 95%无凝露 工作温度: -20°C ~ 60°C 存储温度: -40°C ~ 85°C | 194×148×32.5mm | Linux |

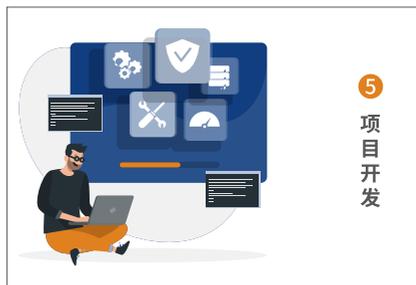
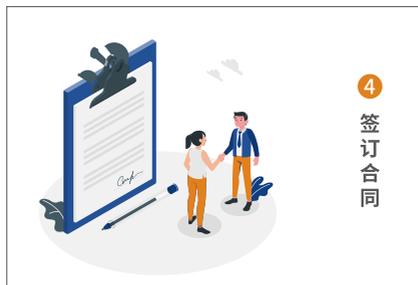
ODM服务

米尔基于多年的行业深耕，在基于ARM/FPGA内核处理器的嵌入式软、硬件开发上，积累了丰富的产品技术和项目开发经验，米尔也针对客户个性化的需求，提供专业，高效的定制服务。

定制方案



定制服务流程



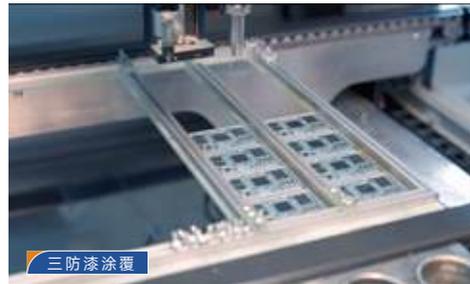
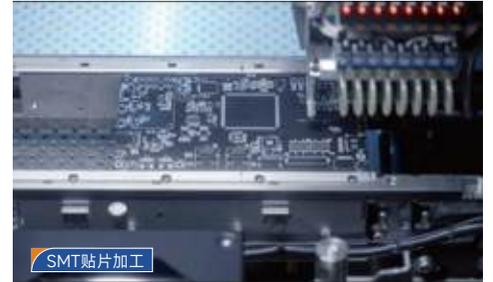
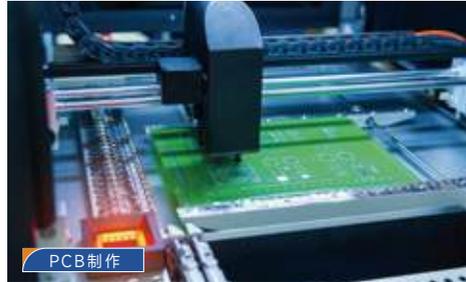
OEM服务



扫一扫了解更多

米尔智慧化SMT工厂致力于给客户id提供从PCB制作、元器件采购、贴片加工到组装测试的一站式PCBA生产服务。米尔工厂位于深圳市龙华区，以先进的生产设备和管理系统、严格的品质管控流程、完善的供应链体系、强力的工程支撑等优势，帮助客户提升生产效率、缩短产品交期、保证生产品质，服务于国内外众多工业控制、电力通讯、新能源、汽车电子、医疗电子、智能家居及安防等各行业客户。

一站式PCBA服务范围



OEM服务覆盖众多行业



工业控制



电力通讯



新能源



汽车电子



医疗仪器



智能安防



工程机械



轨道交通



工业网关



北京分公司
电话: 010-84675491 | 13316862895
地址: 北京市大兴区荣华中路8号院力宝广场10号楼901室



上海分公司
电话: 021-62087019 | 15338794610
地址: 上海市浦东新区金吉路778号浦发江程广场1号楼805室



深圳总部
电话: 0755-25622735 | 17324413392
地址: 深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园2栋604室



武汉分公司&研发中心
电话: 027-59621648
地址: 武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代科技园4号楼1601号



深圳生产基地
电话: 0755-21015844
地址: 深圳市龙华区观澜街道大富工业区圣建利工业园C栋厂房2楼

